Universidad Nacional Autónoma de México FACULTAD DE CIENCIAS

(31) enjul.







Universidad Nacional Autónoma de México



UNAM – Dirección General de Bibliotecas Tesis Digitales Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS © PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor. **TESIS CON FALLA DE ORIGEN**

INDICE

۸

| | | Pag. |
|-----|--|------|
| | INTRODUCCION. | 1 |
| | CAPITULO PRIMERO. SEMICONDUCTORES. | |
| 1.1 | Introducción. | 6 |
| 1.2 | Conductividad eléctrica y movilidad de los portadores | |
| | de carga. | 10 |
| 1.3 | Coeficiente de absorción y brecha energética. | 35 |
| 1.4 | Preparación del subestrato semiconductor Cu ₂ O. | 45 |
| 1.5 | Caracterización del subestrato semiconductor Cu ₂ O. | 49 |
| 1.6 | Discusión y conclusiones. | 62 |
| | | |
| | CAPITULO SEGUNDO. UNIONES Y CELDAS SOLARES DE BARRERA SCHOTTKY. | |
| 2.1 | Introducción. | 65 |
| 2.2 | Homouniones, heterouniones y uniones de barrera Schot <u>t</u> | |
| | ky. | 66 |
| 2.3 | Efecto fotovoltaico y características de celdas sola - | |
| • | res. | 97 |
| 2.4 | Blaboración de las celdas fotovoltaicas. | 110 |
| 2.5 | Caracterización de las celdas fotovoltaicas elaboradas | 113 |

| | Pag. |
|-------------------------------|------|
| 2.6 Discusión y conclusiones. | 128 |
| CONCLUSIONES GENERALES. | 132 |
| BIBLIOGRAFIA. | 137 |

INTRODUCCION

A partir de la Revolución Industrial, la aplicación tecnoló gica de los conocimientos científicos ha ido en acelerado aumento hasta nuestros días, en que la tecnología ocupa un lugar im portante en el desarrollo de la sociedad moderna. Uno de los principales problemas que afrontan, tanto los países desarrollados como aquellos en vía de serlo, es sin duda, la obtención derecursos energéticos suficientes y costeables para mantener su ritmo de crecimiento industrial. La generación de energía hidroeléctrica y geotérmica es insuficiente, el petroleo y en general los hidrocarburos, que hasta hoy satisfacen la demanda energética, generan graves problemas de contaminación además de que porser recursos no renovables están destinados a extinguirse. El aprovechamiento de la energía del viento y mareas al presente esprácticamente nulo; la energía nuclear de fisión deja desechos radiactivos muy peligrosos y también es un recurso no renovable. La energía solar es un recurso renovable que potencialmente es muy prometedor, aunque hasta el momento está poco desarrollada la tecnología para su aprovechamiento a gran escala; es en esterenglón donde las celdas solares juegan un papel importante porque son dispositivos que convierten directamente la energía lumi

-1-

nosa que reciben del sol en una fuerza electromotriz aprovecha ble, que no dejan desechos y prácticamente no requieren mantenimiento.

Existe un interés creciente por la posibilidad de generar potencia eléctrica en gran escala utilizando la energía solar --por medio de dispositivos fotovoltaicos. Las tecnologías actua les de celdas solares están hechas a base de silicio monocristalino, de compuestos de los grupos III-V y II-VI, pero en todos los casos el costo por watt pico generado es muy caro⁽¹⁾. Por ejemplo, en paneles de celdas de silicio monocristalino de 12 🖈 de eficiencia el costo por watt pico de potencia es del orden de 8 dolares⁽²⁾ y para que los sistemas fotovoltaicos sean costea bles para producir potencia a escala significativa el costo debe reducirse en un orden de magnitud. El trabajo que se realiza enel campo fotovoltaico es precisamente bajar los costos de elaboración de las celdas solares; una de las direcciones que prome ten bajar el costo de los procesos de producción es la fabrica ción de subestratos semiconductores a partir de la oxidación decapas metálicas. En particular, la oxidación de láminas de cobre, metal relativamente abundante en la naturaleza y barato, para -formar el subestrato semiconductor Cu₂O. Los estudios sugieren que se podrían alcanzar eficiencias reales del 10 % (eficiencia-

- 2 -

teórica 13 %) con celdas hechas a base de Cu₂O y de lograrse esto el costo por watt pico de potencia sería del orden de 10 a 25 centavos de dolar⁽¹⁾.

La historia de los dispositivos rectificadores metal-semi conductor usados en la electrónica se remota a 1874 cuando apar<u>e</u> ció publicado un escrito sobre la materia por Braun reportando la naturaleza asimétrica de la conducción entre puntos metal y cristales como el sulfuro de plomo⁽³⁾; sus aplicaciones como detectores de radio frecuencia es tan antigua como la telegrafía misma.

El subestrato semiconductor Cu_20 tiene grandes ventajas para ser utilizado en dispositivos fotovoltaicos, entre otras, que sus transiciones electrónicas interbandas son directas⁽⁴⁾; su es pectro de absorción se acopla bastante bien al espectro de emi sión solar, ya que su brecha energética es del orden de 2 eV (co mo se verá en la sección 1.3 de este trabajo). El Cu₂0 es fácilde producir por calentamiento de láminas de Cu en atmósfera normal.

El Instituto de Investigaciones en Materiales de la U.N.A.M. desarrolla actualmente un proyecto de elaboración de celdas sola res a partir de Cu₂0, donde se realizan estudios básicos tendie<u>n</u> tes a producir celdas eficientes. Se han hecho estudios sobre --

- 3 -

sistemas Cu_2 O/Cu tanto en pared anterior^(5,6) como de pared posterior⁽⁷⁾. El presente trabajo forma parte de dicho proyecto y tiene dos objetivos principales ; el primero de ellos, es efec tuar la caracterización del subestrato semiconductor Cu_2 O, obtenido en la oxidación por el calentamiento de láminas de cobre -grado metalúrgico a altas temperaturas en atmósfera normal. El semiconductor obtenido de esta manera fue utilizado en la elaboración de celdas fotovoltaicas tanto en el presente trabajo como en los estudios antes mencionados en los que no se hizo dicha c<u>a</u> racterización. El segundo objetivo es investigar la influencia de diferentes metales (Cu, In, Cr, Al) que forman contacto rect<u>i</u> ficador con el Cu₂O en lo que se refiere al alto de la barrera,eficiencia y otros parámetros fotovoltaicos de celdas solares --Cu₂O/metal en el arreglo de pared unterior.

En el capítulo primero de ente trabajo se dará un esquema teórico de la determinación de la conductividad eléctrica, la mo vilidad y la concentración de los portadores de carga, así comola elaboración y caracterización del subestrato semiconductor ---Cu₂O. En el capítulo segundo se expondrá someramente la forma _-ción de diferentes tipos de uniones y se desarrolla más amplia mente la unión metal-semiconductor de barrera Schottky que es la utilizada en este trabajo para la elaboración de celdas solares-

- 4 -

de Cu₂0/In, Cr, Al, Cu, de pared anterior y finalmente se hace la caracterización de dichas celdas.

- 5

CAPITULO PRIMERO SEMICONDUCTORES

1.1 Introducción.

La aplicación de la mecánica cuántica al comportamiento delos electrones dentro de una red cristalina (sólido cristalino)por medio de las funciones de Bloch, que son la forma general de las funciones de onda de los electrones en un potencial periódico, lleva a que la solución de la ecuación de Schrödinger sólo se tenga para valores discretos de la energía dentro de ciertasbandas de energía permitidas y la existencia de otras bandas deenergía prohibidas. Las características generales de estos dos tipos de bandas, su ancho, la separación entre ellas (sobre todo las superiores) y su posible traslape, depende de la aproxima -ción que se haga en el modelo (como la del electrón libre y amarre fuerte) de acuerdo al tipo de material tratado.

La existencia de bandas de energía permitidas y prohibidas, el llenado de sus estados cuánticos disponibles por los electrones que forman el material de acuerdo al principio de exclusiónde Pauli, explican satisfactoriamente el por qué algunas sustancias se comportan como metales, semiconductores o aislantes. Este comportamiento no se puede entender mediante la teoría clási-

- 6 -

ca del electrón libre.

Las características principales de los metales, como su alta conductividad eléctrica y térmica, así como su alta reflectividad óptica; las propiedades de los aislantes (o dieléctricos)y semiconductores, que son en general opuestas a las de los meta les, se explican en base de la mecánica cuántica.

De acuerdo al principio de exclusión de Pauli, a la tempera tura del cero absoluto, los electrones del material (sistema) ocupan los estados cuánticos disponibles en las bandas de energía permitidas, desde el estado de energía más bajo hasta una cierta energía llamada nivel de Fermi, por lo que habrá algunas bandasde energía totalmente llenas, algunas totalmente vacías y una ovarias bandas que se traslapen pueden estar parcialmente llenas. Cuando el número de electrones en el cristal, es justo el necesa rio para llenar completamente un cierto número de bandas de ener gía permitidas, a la temperatura del cero absoluto, quedando las demás completamente vacías, el material se comportará como ais lante. La banda de energía llena más alta se denomina banda de valencia y la banda de energía más baja completamente vacía es la banda de conducción. El ancho de la banda de energía prohibida que separa la banda de conducción de la banda de valencia --constituye la brecha de energía prohibida Eg, que juega un papel

-7 -

muy importante, ya que dependiendo de su valor, el material se comportará como aislante típico o con propiedades de semiconductor.

Si el llenado de los estados cuánticos disponibles en las bandas de energía permitidas, a la temperatura de cero absoluto, queda una o varias bandas de energía que se traslapan parcialmen te llenas, el material se comportará como metal. A $T \neq 0$ K, estos electrones estarán libres de moverse y transportarán fácilmenteenergía.

Por lo dicho antes, la diferencia entre un aislante y un se miconductor es sólo de grado, ya que si $E_g < 3$ eV el material secomportará como semiconductor, en caso contrario será un aislante. En el semiconductor (intrínseco) a la temperatura ambiente,algunos electrones de la banda de valencia adquieren la energíatérmica suficiente para pasar a la banda de conducción donde semoverán libremente dejando un número igual de estados vacíos a los cuales se les puede asociar el comportamiento de partículascon carga positiva libres de moverse en la banda de valencia, -llamadas huecos, conduciendo así la corriente eléctrica por losdos mecanismos: por electrones y por huecos.

En los semiconductores extrínsecos, si el mecanismo dominan te de conducción se lleva a cabo por electrones se le denomina -

- 8 -

semiconductor tipo n y cuando el mecanismo de conducción dominante es por huecos se le llama semiconductor tipo p.

Así pues, a la temperatura ambiente los semiconductores pu<u>e</u> den tener propiedades similares tanto a las de metales como a -las de aislantes según las condiciones a que estén sometidos.

El comportamiento macroscópico de los materiales desde el punto de vista eléctrico, es caracterizado, entre otros paráme tros, por la conductividad. En los metales a la temperatura am biente⁽⁸⁾ está dentro del intervalo de lo⁶ a lo⁶ (ohm-cm)⁻¹, aunque un buen conductor⁽⁹⁾ tiene una conductividad de lo⁶ (ohm-cm)⁻¹ a ba jas temperaturas; a temperatura ambiente para los semiconducto res la conductividad está en el intervalo de lo⁶ a lo⁶ (ohm-cm)⁻¹,y la de los aislantes menor de lo⁻¹⁶ (ohm-cm)⁻¹, pero un aislante bueno⁽⁹⁾ sería de una conductividad de lo⁻¹⁸ (ohm-cm)⁻¹.

Otros parámetros, además de la conductividad, que caracter<u>i</u> zan a un semiconductor son la movilidad de los portadores de ca<u>r</u> ga, tipo y su concentración; el coeficiente de absorción y el a<u>n</u> cho de la brecha de energías prohibidas E_{p} .

Se hará un análisis teórico de dichos parámetros en las siguientes secciones y se caracterizará al subestrato semiconduc tor óxido cuproso, que es el utilizado en este trabajo en la el<u>a</u> boración de celdas fotovoltaicas de barrera Schottky.

- 9 -

1.2 Conductividad eléctrica y movilidad de los portodores de carga.

En esta sección como ya se mencionó, se desarrollarán las expresiones más importantes de la conductividad, parámetro que se requiere en la caracterización de un semiconductor y que está ligado directamente con la movilidad de los portadores de carga.

Se determinará primero, en una aproximación burda⁽⁸⁾, la -conductividad de un semicónductor tipo n cuyos electrones de con ducción se consideran como partículas clásicas con determinadas posiciones y velocidades en cada instante. Por definición la den sidad de corriente \hat{i} es:

$$\hat{j} = -en\langle \hat{v} \rangle , \qquad (1.2.1)$$

donde n es la concentración de electrones libres en la banda deconducción, es decir, el número de electrones libres por unidadde volumen del material, $\langle \hat{\mathbf{v}} \rangle$ la velocidad media de arrastre y \boldsymbol{e} su carga eléctrica.

La velocidad media de arrastre de los electrones $\langle \hat{\mathbf{v}} \rangle$ puede calcularse teniendo en cuenta que el equilibrio térmico es un -concepto estadístico y por tanto el tiempo de recorrido libre de los portadores tiene un carácter probabilístico . La velocidad media de arrastre se determina por tanto con la expresión

$$\langle \hat{J} \rangle = \frac{\hat{\mathbf{x}}}{T} , \qquad (1.2.2)$$

- 10 -

donde \hat{X} es la distancia total que recorren los n_o portadores decarga del material hasta que se dispersan por colisiones con lared cristalina y T es el tiempo total que emplean dichos portad<u>o</u> res en recorrer la distancia total \hat{X} .

Si Υ es el tiempo de recorrido libre medio de los n_o portadores, el Υ iempo total será

$$T = n \cdot \tau , \qquad (1.2.3)$$

donde $\boldsymbol{\gamma}$ es considerado una cantidad constante.

Por otro lado, la disminución en el número de portadores que se mueven en una dirección prefijada es

$$-dn=n\frac{dt}{r}, \qquad (1.2.4)$$

donde $n \frac{dt}{\tau}$ es la probabilidad de que n portadores se dispersen en un tiempo dt, y por lo tanto

$$n(t) = n_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 (1.2.5)

es el número de portadores que no se han dispersado al tiempo t. Cuando el electrón se halla en un campo eléctrico $\hat{\epsilon}$, recorre, en su tiempo de recorrido libre t, la distancia $x = -\frac{e\hat{\epsilon}}{2m}t^2$, por lo que la distancia total \hat{X} que recorren los n_o portadoreshasta dispersarse es

$$\hat{\mathbf{x}} = \int_{\infty}^{\infty} \hat{\mathbf{x}} n \frac{dt}{T} = -\frac{en_{0}\tau^{2}\hat{\varepsilon}}{m} . \qquad (1.2.6)$$

- 11 -

Con las relaciones (1.2.2), (1.2.3) y (1.2.6) la velocidadmedia de arrastre queda expresada como

$$\langle \hat{\mathcal{G}} \rangle = - \frac{e^{\gamma}}{m} \hat{\mathcal{E}} .$$
 (1.2.7)

La densidad de corriente 2 dada por (1.2.1) sustituyendo la relación (1.2.7) resulta

$$\hat{\delta} = \frac{e^{s}n\gamma}{m}\hat{\varepsilon} = \sigma\hat{\varepsilon}, \qquad (1.2.8)$$

donde o es la conductividad del material, definida por

$$\sigma = \frac{e^{2}n\tau}{m} \qquad (1.2.9)$$

La movilidad de los portadores de carga µ se define como la velocidad media de arrastre por unidad de campo eléctrico, eg to es

$$\mu = \frac{\langle \hat{\mathcal{G}} \rangle}{\mathcal{E}} = \frac{e\gamma}{m} \qquad (1.2.10)$$

Tomando en consideración las relaciones (1.2.9) y (1.2.10), se tiene que la conductividad G se puede expresar como

$$\sigma = e_{n\mu}, \qquad (1.2.11)$$

En la expresión (1.2.11) se tiene una relación de la conduc tividad o con la concentración n y movilidad de los portado res de carga. La medida de la conductividad de un material es in

- 12 -

suficiente para determinar los otros dos parámetros y es necesario otro tipo de resultados independientes, que se obtienen analizando el efecto Hall.

Continuando en la aproximación de partículas clásicas, cuan do en un material, que se halla en un campo magnético \hat{B} , se ha ce circular una densidad de corriente \hat{j} , como se muestra en lafigura (1.2.1), sobre los portadores de carga q actúa la componente magnética de la fuerza de Lorentz $\hat{F} = q(\hat{\sigma} * \hat{B})$ que origina una polarización en los extremos del material en dirección perpen dicular al flujo de la corriente, generando un campo eléctrico- \hat{E}_{M} , que en estado estacionario equilibra la fuerza de Lorentz. Esto lleva a que el campo eléctrico de Hall E_{M} se exprese como

$$E_{n} = \langle v_{n} \rangle B$$
 (1.2.12)

De las relaciones (1.2.1) y (1.2.12) se obtiene el campo eléctrico de Hall E_u está dado por

$$E_{\mu} = -\frac{1}{e_{\mu}} \frac{1}{j}B$$
. (1.2.13)

Anora, si la separación entre los extremos del material enla dirección transversal a la densidad de corriente es d , (véa se figura 1.2.1) se tiene que la diferencia de potencial $V_{\rm N}$ entre dichos extremos, llamado voltaje de Hall, será

$$v_{\mu} = \varepsilon_{\mu}d = RjBd$$
, (1.2.14)

- 13-



Fig. 1.2.1 Geometría del experimento del efecto Hall. Se observa la polarización producida cuando la corriente eléctrica está dada por huecos. donde R es el coeficiente de Hall, definido por

$$R = -\frac{1}{en}$$
 (1.2.15)

El coeficiente de Hall es el factor de proporcionalidad entre el voltaje de Hall y el producto de la densidad de corriente, el campo magnético y el ancho de la muestra, por lo que al ser determinado experimentalmente, se obtiene la concentración y eltipo de portadores de carga. El coeficiente de Hall es negativocuando la conductividad está dada por electrones y positivo cuan do está dada por huecos.

Con la concentración de portadores de carga y la medida dela conductividad, se puede determinar, a través de la relación -(1.2.11), la movilidad de los portadores de carga en el material teniéndose de esta manera, tres de los parámetros importantes en la caracterización de un semiconductor.

En la determinación de los parámetros anteriores, no se hatomado en cuenta la distribución estadística de velocidades de los portadores de carga en el material, por lo que es un cálculo burdo como se mencionó, sin embargo ilustra de forma sencilla la definición de los parámetros antes dichos. Si se quiere hacer un cálculo más preciso, es necesario considerar la distribución estadística de velocidades, a través de la ecuación cinética de --Boltzmann para un sistema en estado de no equilibrio y tomar como función en estado de equilibrio la Fermi-Dirac o Maxwell -Boltzmann según se trate de un semiconductor degenerado o no degenerado respectivamente.

En un sistema en estado de no equilibrio termodinámico, resultante de la aplicación de campos externos (eléctrico, magnét<u>i</u> co, térmico, etc.), tienen lugar los fenómenos llamados cinéti cos o de transporte, por lo que el sistema de portadores se describe por una función de desequilibrio f , que depende de la <u>e</u> nergía de dichos portadores a través del vector de onda \hat{k} , de sus coordenadas y del tiempo, es decir, $f(\hat{r}, \hat{k}, t)$.

La función de distribución f ($\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{k}}, \mathbf{t}$) está contenida en la ecuación cinética de Boltzmann⁽⁸⁾

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{campo} + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{chaque} , \qquad (1.2.16)$$

donde

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{campo}} = -\left(\hat{\varphi} \cdot \nabla_{\hat{\varphi}} f\right) - \frac{1}{t_1}\left(\hat{\tau} \cdot \nabla_{k} f\right) \quad (1.2.17)$$

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{changue}} = \frac{1}{4\pi^3} \int w(\hat{k}, \hat{\kappa}) [f(\hat{k}') - f(\hat{k})] d\eta_{k'}. \quad (1.2.18)$$

- 16 -

F es la fuerza determinada por los campos externos, $\hat{\mathbf{v}}$ es la velocidad de los portadores de carga y w($\hat{\mathbf{k}}$, $\hat{\mathbf{k}'}$) es la probabilidad de transición en la unidad de tiempo de que un electrónpase del estado $\hat{\mathbf{k}}$ al estado $\hat{\mathbf{k}'}$.

El sentido físico de la ecuación cinética de Boltzmann ---(1.2.16), en el primer miembro refleja la variación de la fun -ción de distribución en el tiempo; en el segundo miembro, el té<u>r</u> mino del campo muestra las variaciones de la función de distrib<u>u</u> ción en el espacio ordinario y en el espacio del vector de onda- \hat{k} , originadas por la acción de los campos externos; y el térm<u>i</u> no de choque la variación de la función de distribución de los portadores, debido a su dispersión por las perturbaciones loca les en la periodicidad de la red cristalina.

La ecuación cinética de Boltzmann (1.2.16) es una ecuacióncasi clásica⁽⁸⁾, puesto que en la función de distribución se dan simultaneamente la posición y el vector de onda, por lo que sólo es aplicable a los procesos para los cuales tiene sentido la noción de longitud de recorrido libre, es decir, que la longitud media de recorrido libre de los portadores de carga debe ser mayor que su longitud de onda.

La ecuación cinética de Boltzmann puede ser resuelta, en -principio, para la función de distribución, cuando se conoce el-

- 17 -

campo de fuerza \hat{F} y la razón de cambio en $\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)$ choque. Aunque en general es muy compleja y es necesario hacer aproximaciones.

En el caso de procesos estacionarios, esto es, cuando las magnitudes que describen los fenómenos de transporte no dependen del tiempo, $\frac{\partial f}{\partial t} = 0$, la ecuación cinética de Boltzmann tiene la -forma

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right) = -\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{choque}$$
, (1.2.19)

o sea que en estado estacionario, las variaciones de la funciónde distribución, causadas por el movimiento de los portadores de carga y la acción sobre ellos de las fuerzas externas, se compen san por los choques de los portadores con las perturbaciones locales de la periodicidad del campo de la red cristalina.

Como se dijo anteriormente, la solución de la ecuación ciné tica de Boltzmann es muy compleja, aún para el caso estacionario pero se simplifica bastante cuando la descripción de los proce sos de dispersión se puede hacer mediante el tiempo de relaja -ción, si al chocar se altera poco la energía de los portadores de carga y si los procesos de dispersión dan lugar a una distribución aleatoria de velocidades, como es el caso.

Supóngase que al tiempo t=0 en el sistema, descrito por lafunción de desequilibrio f , han dejado de actuar los campos -

+ 18 -

externos, por lo que el término del campo se hace cero, y debido a los choques de los portadores el sistema pasa al estado de e quilibrio descrito por la función de distribución f_0 . En estecaso, la ecuación cinética de Boltzmann se reduce a

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{chaque}} \qquad (1.2.20)$$

es decir, la variación de la función de distribución es debida a los choques de los portadores de carga con los defectos locales_ de la red cristalina.

Si la desviación de la distribución de los portadores de carga respecto del estado de equilibrio es pequeño (8), se puedesuponer que sin campos externos, la rapidez de variación de la función de distribución f, debida a los choques, es proporcional a la magnitud de su desviación del estado de equilibrio, esdecir, proporcional a $f-f_0$, por lo que

$$\frac{\partial f}{\partial t} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{choque}} = -\frac{f-f_o}{\tau(\hat{\kappa})} , \qquad (1.2.21)$$

donde el coeficiente de proporcionalidad $\frac{1}{\gamma(k)}$ depende de la energía con \hat{k} . La solución de la ecuación (1.2.21) es

$$f_{-}f_{*} = A e^{-\frac{t}{\tau}}$$
, (1.2.22)

donde A es una constante. Se observa que al interrumpirse la ac-

+ 19 +

ción del campo, la función de distribución f se aproxima a ladel equilibrio f_0 exponencialmente con una constante de tiempo- γ , llamada tiempo de relajación, esto es, γ es el tiempo medio durante el cual en el sistema existe una distribución desequilibrada de portadores de carga después de que los campos externosdejan de actuar.

Por otro lado, si los campos externos no conducen a varia ciones fuertes en la función de equilibrio, la función f se -puede expresar como

$$f(\hat{k}) = f_0 + f_1(\hat{k})$$
, (1.2.23)

donde $f_i(\hat{k})$ es la corrección a la función de distribución de equilibrio, debido a la acción de los campos externos sobre el -sistema y γ (\hat{k}) determina los procesos de dispersión en presen cia de campos externos considerando que el tiempo de relajaciónno depende de dichos campos.

Se determinará ahora en forma más precisa la conductividaddel material, la movilidad y la concentración de portadores de carga, tomando en cuenta la función de distribución por medio de la ecuación cinética de Boltzmanñ.

Será tratado un semiconductor homogeneo y no degenerado cuyas superficies isoenergéticas son esferas. Para obtener la con-

-120 -

ductividad $abla^{-}$ del semiconductor, supóngase que se encuentra en un campo eléctrico homogeneo de intensidad constante \mathcal{E} .

En el elemento de volumen $\exists V_k$ de un cristal de volumen un<u>i</u> dad, la cantidad de electrones es

$$dn = f(k) \frac{dV_k}{4\pi^3}$$
 (1.2.24)

La densidad de corriente que crean estos electrones al moverse por la acción del campo eléctrico a la velocidad \hat{v} será

$$d\hat{j} = -ef(\hat{k}) \frac{dV_k}{4\pi^3} \hat{j}$$
 (1.2.25)

Si el semiconductor tiene dos tipos de portadores de carga, elec trones y huecos, la densidad de corriente total **î es**

$$\hat{J} = \hat{J}_{\mu} + \hat{J}_{p} = \frac{-e}{4\pi^{3}} \int \hat{\mathcal{V}}_{n} f_{\mu}(\hat{k}) dV_{k} + \frac{e}{4\pi^{3}} \int \hat{\mathcal{V}}_{p} f_{p}(\hat{k}') dV_{k'}, \quad (1.2.26)$$

donde los índices n y p son para denotar las cantidades co rrespondientes a electrones y huecos respectivamente; la inte -gral es sobre toda la zona de Brillouin. Se considerará primeroel término correspondiente a â, de la relación (1.2.26)

Sea la función de desequilibrio $f(\hat{k})$ dada por (1.2.23). Sustituyendo en el término correspondiente a \hat{f}_{M} en (1.2.26) se tiene

$$\hat{J}_{n} = -\frac{e}{4\pi^{3}}\int_{VB}\hat{U}_{n}f_{in}(\hat{k})dv_{k}$$
; (1.2.27)

la corrección $f_1(k)$ se puede determinar a partir de las condiciones de estado estacionario de la ecuación cinética de Boltz mann

$$-\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{eamps}} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{ehoque}} = -\frac{f(\hat{k}) - f_{o}}{\tau(\hat{k})} = -\frac{f_{1}(\hat{k})}{\tau(\hat{k})} \cdot (1.2.28)$$

El término del campo es de acuerdo con la expresión (1.2.17)

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{eaupo} = -\left(\Im \nabla \varphi f\right) - \frac{1}{\hbar} \left(\widehat{F} \cdot \nabla \widehat{\varphi} f\right) \quad (1.2.29)$$

que se reduce a

$$\left(\frac{\partial 4}{\partial t}\right)_{\text{camps}} = -\frac{1}{4} \left(\hat{\mathbf{F}} \cdot \nabla_{\hat{\mathbf{L}}} \hat{\mathbf{f}}\right) \qquad (1.2.30)$$

debido a que $\nabla_{\hat{Y}} \hat{f}$ en (1.2.29) se anula para el semiconductor homogeneo que se está considerando. La variación de la función dedistribución bajo la acción del campo eléctrico $\hat{\mathcal{E}}$, que produce sobre los electrones con masa efectiva \mathbf{n}_{n}^{*} y de energía ----- $\mathbf{E} = \frac{\hbar^{2} K^{2}}{2 m_{n}^{2}}$ una fuerza $\hat{F} = \hbar \frac{d\hat{\kappa}}{dt} = -\boldsymbol{e} \hat{\boldsymbol{E}}$, es por tanto

$$\left(\frac{\partial f_u}{\partial t}\right)_{\text{campo}} = -\frac{1}{n} \left(\hat{F} \nabla_{\hat{k}} f_u\right) = -\frac{\partial \hat{k}}{\partial t} \frac{\partial f_u}{\partial \epsilon} \frac{\partial \epsilon}{\partial k} = \frac{e^{\frac{1}{n}}}{m_u^2} \frac{\partial f_u}{\partial \epsilon} \left(k\epsilon\right) \quad (1.2.31)$$

De las relaciones (1.2.28) y (1.2.31) resolviendo para $f_1(\hat{k})$.

$$f_{1}(\vec{x}) = \frac{e\pi}{m_{u}^{u}} \tau(\vec{x}) \frac{\partial t_{u}}{\partial \epsilon} (\vec{x} \epsilon) ; \qquad (1.2.32)$$

- 22 -

si se sustituye esta relación en (1.2.27), se tiene que

$$\hat{\mathbf{J}}_{n} = -\frac{e^{2}\hbar}{4\pi^{3}m_{\pi}^{4}} \int \hat{\mathbf{G}}_{n} \tau_{n}(\hat{\mathbf{z}}) \frac{\partial f_{n}}{\partial E} (\hat{\mathbf{x}} E) dV_{k} , \qquad (1.2.33)$$

donde $\Upsilon_{n}(\hat{k})$ es el tiempo de relajación para los electrones. Deque $\hat{\beta} = m_{n}^{*}\hat{G} = \frac{\pi}{n}\hat{k}$, la velocidad de los electrones es $\hat{G}_{n} = \frac{\pi}{m_{n}}\hat{k}$; de esto, la relación (1.2.33) resulta

$$\hat{J}_{n} = -\frac{e^{2} \hbar^{2}}{4\pi^{3} m_{H}^{32}} \int_{VB} \mathcal{T}_{n}(\hat{k}) \frac{\partial \hat{f}_{u}}{\partial E} (\hat{k} E) \hat{k} dV_{k} . \qquad (1.2.34)$$

Como ya se dijo, $f(\hat{k})$ no difiere mucho de la función de distribu ción de equilibrio f_0 y se puede sustituir $f_n(\hat{k})$ por f_0 , que para un semiconductor no degenerado es la función de distribu -ción de Boltzmann $f_0 = e^{-\frac{E-F}{KT}}$, y por tanto

$$\frac{\partial t_{u}}{\partial E} = \frac{\partial t_{e}}{\partial E} = -\frac{1}{\kappa_{T}} e^{-\frac{E-E}{\kappa_{T}}} (1.2.35)$$

La concentración de electrones en este caso es

$$h = N_{e}e^{-\frac{E_{e}-F}{KT}} = N_{e}e^{\frac{F}{KT}}$$
 (1.2.36)

cuando la energía se toma desde el fondo de la banda de conduc – ción, $E_c=0$, donde N_c es la densidad efectiva de estados enla banda de conducción, que está dada por

$$N_{c} = 2 \left(\frac{2\pi m_{n}^{*} \kappa \tau}{t_{1}^{2}} \right)^{3/2} . \qquad (1.2.37)$$

- 23 -

Sustituyendo la relación (1.2.37) en (1.2.35), se obtiene

$$\frac{\partial f_n}{\partial \epsilon} = -\frac{n}{N_e \kappa T} e^{-\frac{\epsilon}{\kappa T}}, \qquad (1.2.38)$$

por lo que la densidad de corriente electrónica, resulta

$$\hat{J}_{n} = \frac{e^{2} h^{2} n}{4 \pi^{3} m_{\pi}^{2} \kappa_{T} N_{c}} \int \mathcal{T}_{n}(\hat{\kappa}) e^{\frac{\kappa}{kT}} (\hat{\kappa} e) \hat{\kappa} dV_{\kappa} . \qquad (1.2.39)$$

utilizando la relación

$$\int F(k) (\hat{a} \hat{k}) \hat{k} \, dV_{k} = \frac{4\pi}{3} \hat{a} \int_{0}^{\infty} F(k) k^{4} dk , \quad (1.2.40)$$

la expresión (1.2.39) se escribe de la forma

$$\hat{J}_{n} = \frac{e^{k}h^{k}n}{4\pi^{3}m_{n}^{4}} \frac{e^{4}}{kTNc} \frac{4\pi}{3} \int \mathcal{T}_{u}(\hat{k}) e^{-\frac{E}{kT}} \kappa^{4} d\kappa . \qquad (1.2.41)$$

Definase $d = \frac{\epsilon}{\kappa \tau}$, y por tanto

$$k^{4} L k = \frac{(2m_{1}^{4} kT)^{2}}{2m^{2}} \lambda^{3/2} L \lambda$$
 (1.2.42)

Sustituyendo en la relación (1.2.41) las relaciones(1.2.37) y = (1.2.42), se tiene

$$\hat{J}_{n} = \frac{e^{2}n}{m_{s}} \mathcal{E} \frac{4}{3\sqrt{n}} \int_{0}^{\infty} \mathcal{T}_{n}(\hat{k}) d^{2}e^{-d}dd; \quad (1.2.43)$$

ya que el tiempo de relajación es

$$\langle T_{n}(R) \rangle = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{0}^{\infty} T_{n}(R) \alpha^{\frac{3}{2}} e^{-\alpha} d\alpha, \quad (1.2.44)$$

- 24 -

la densidad de corriente electrónica (1.2.43) se expresa como

$$\hat{J}_{n} = \frac{e^{2} n < \tau_{n}(\hat{k}) >}{m_{n}^{*}} \mathcal{E} = \sigma_{n} \mathcal{E} = en u_{n} \mathcal{E}, \quad (1.2.45)$$

donde

$$\sigma_n = en \mu_n \qquad (1.2.46)$$

es la conductividad debida a los electrones y

$$u_n = \frac{e < \tau_n(\hat{k})}{m_n^*} \qquad (1.2.47)$$

es la movilidad de los portadores de carga electrónicos.

De manera similar se puede obtener la dénsidad de corriente debida a huecos \hat{J}_{p} :

$$\hat{J}_{p} = \frac{e^{2}P \langle \mathcal{T}_{p}(\hat{k}') \rangle}{m_{0}^{*}} \mathcal{E} = \nabla_{p}\mathcal{E} = eP \mu_{p}\mathcal{E} . \qquad (1.2.48)$$

La densidad de corriente total del semiconductor que tienelos dos tipos de portadores de carga de acuerdo con las relaciones (1.2.45) y (1.2.48), es

$$\hat{J} = \hat{J}_{n} + \hat{J}_{p} = (\sigma_{n} + \sigma_{p}) E = \sigma_{E}$$
, (1.2.49)

donde la conductividad total σ es la suma de las conductivida des σ_n y σ_p .

Si el semiconductor es del tipo p , entonces $\hat{f}_{u} < \hat{f}_{p}$ y la densidad de corriente total \hat{f}_{u} será

- 25 -

$$\hat{J} = \hat{J}_{p} = \sigma_{p} \mathcal{E}$$
 (1.2.50)

La conductividad y la movilidad de los portadores de cargason similares a las expresiones (l.2.10) y (l.2.11) determinadas anteriormente, con la diferencia de que al incorporar la distribución estadística de velocidades de los portadores de carga, el tiempo de relajación depende de la energía a través de $\hat{\mathbf{k}}$.

La conductividad se relaciona con la movilidad mediante laecuación (1.2.46) por lo que, para obtener la movilidad se re -quiere la concentración de portadores o el tiempo de relajación. Para la determinación de la concentración de portadores se util<u>i</u> zan las medidas del efecto Hall, pero tomando en cuenta la dis persión de los portadores a través de la ecuación cinética de --Boltzmann.

Para determinar el coeficiente de Hall R , se calcula la densidad de corriente, es decir:

$$\hat{J} = \hat{J}_{n} + \hat{J}_{p} = -\frac{e^{\frac{1}{4\pi^{3}}}}{4\pi^{3}m_{\pi}^{4}} \int_{VB} \hat{k} f_{in}(\hat{k}) dV_{k} + \frac{e^{\frac{1}{4\pi^{3}}}}{4\pi^{3}m_{\pi}^{4}} \int_{VB} \hat{k}' f_{ip}(\hat{k}') dV_{k'}, \quad (1.2.51)$$

donde para hallar f,(\hat{k}) se utiliza la ecuación cinética de -Boltzmann para el caso de estado estacionario con f(\hat{k})=f_o+f_i(\hat{k}), esto es

$$(\hat{\sigma}\cdot\nabla_{k}f)+\frac{1}{4}(\hat{F}\cdot\nabla_{k}f)=-\frac{f_{1}(\hat{k})}{\tau(\hat{k})}. \qquad (1.2.52)$$

- 26 -

Para un semiconductor homogeneo, $\nabla_r f = 0$, por lo que la expresión (1.2.52) se reduce a

$$\frac{1}{4}(\hat{F}\cdot\nabla_{k}f) = -\frac{f_{1}(k)}{\tau(k)}$$
 (1.2.53)

La fuerza de Lorentz $\hat{F} = q(\hat{E} + \hat{\nabla} \times \hat{B})$ es la que actúa sobrelos portadores de carga por la acción del campo eléctrico \hat{E} y el campo magnético \hat{B} . Se supondrá que \hat{B} es un campo magné tico débil y perpendicular a la velocidad de los portadores de carga. El hecho de que el campo magnético sea débil se expresa por la condición de que el tiempo de relajación Υ del porta dor de carga es mucho menor que el periodo de revolución ∇_c por una órbita circular en el campo magnético, es decir, $\Upsilon << \nabla_c$. como se sabe (\hat{B}) , la frecuencia w_c de revolución de los portado res de carga de masa efectiva m^{*} por una órbita circular en elcampo magnético (frecuencia w_c de resonancia ciclotrónica) es <u>i</u> gual a

$$w_c = \frac{2\pi}{T_c} = \frac{e}{m^*} B;$$
 (1.2.54)

con esta expresión, la condición de campo débil puede escribirse como

$$\tau \ll \frac{m^*}{e} \frac{2\pi}{B} \qquad (1.2.55)$$

Considerando la movilidad de los portadores de carga $\mu = \frac{e\gamma}{m^2}$, la

- 27 -

condición (1.2.55) queda expresada como

$$\mu B << 1$$
; (1.2.56)

sustituyendo ahora, la fuerza de Lorentz en la expresión (1.2.53) se obtiene

$$\frac{e}{\pi} \left(\varepsilon + \upsilon B \right) \nabla_{\mu} f = -\frac{f_{1}(\vec{k})}{\tau(\vec{k})} . \qquad (1.2.57)$$

Definiendo

$$f_{1}(\hat{k}) = -\frac{\partial f_{0}}{\partial \epsilon} \hat{k} \hat{k}(\epsilon) , \qquad (1.2.58)$$

donde $\hat{\chi}(\varepsilon)$ es un vector dependiente sólo de la energía de losportadores de carga.

Como se suponen campos débiles, la función de desequilibrio $f(\hat{z}) = f_0 + f_1(\hat{z})$ no difiere mucho de f_0 , por lo que en larelación (1.2.57) se puede poner en su lugar f_0 para la partedel campo eléctrico, y como $\nabla_{k}f_0 = \frac{\partial f_0}{\partial z} = \frac{\partial f_0}{\partial z} + \frac{\partial f_0}{\partial z}$, laparte de f_0 en el término del campo magnético se anula, la rela ción (1.2.57) queda en la forma

$$\frac{e}{\pi} \in \nabla_{\kappa} f_{\bullet} + \frac{e}{m} (\sigma B) \nabla_{\kappa} f_{\iota}(\hat{\kappa}) = -\frac{f_{\iota}(\bar{\kappa})}{\tau(\Omega)} \cdot (1.2.59)$$

De la relación (1.2.58) se tiene

$$\nabla_{\mathbf{k}}f_{1}\left(\hat{\mathbf{k}}\right) = -\nabla_{\mathbf{k}}\left\{\frac{\partial f_{0}}{\partial \varepsilon}\,\hat{\mathbf{k}}\cdot\hat{\mathbf{x}}\right\} = -\frac{\partial f_{0}}{\partial \varepsilon}\,\hat{\mathbf{x}} - \left\{f_{1}\hat{\mathbf{k}}\frac{\partial}{\partial \varepsilon}\left(\frac{\partial f_{0}}{\partial \varepsilon}\,\hat{\mathbf{x}}\right)\right\}\hat{\mathbf{v}}.$$
 (1.2.60)

- 28 -

Tomando en cuenta las relaciones (1.2.58) y (1.2.60) de la relación (1.2.59) se obtiene

$$f_{1}(\mathbf{R}) = -\frac{\partial f_{0}}{\partial \mathbf{E}} \, \mathbf{R} \, \hat{\mathbf{r}} = \mathbf{e} \, \mathbf{r}(\mathbf{R}) \, \frac{\partial f_{0}}{\partial \mathbf{E}} \left\{ \mathbf{E} - \frac{1}{\mathbf{n}} \, \mathbf{B} \, \mathbf{R} \right\} \, \hat{\mathbf{r}} \,, \quad (1.2.61)$$

de donde, para los electrones

$$\chi_{n} = -\frac{e^{\frac{1}{2}T_{u}(\vec{k})}}{m_{u}^{*}} \left\{ E - \frac{1}{m} \hat{B} \cdot \hat{\chi}_{n} \right\}, \qquad (1.2.62)$$

y para los huecos

$$\chi_{p} = -\frac{e\hbar \Psi_{p}(\hat{z})}{m_{p}^{*}} \left\{ E - \frac{1}{N} \hat{B} \hat{\chi}_{p} \right\}. \qquad (1.2.63)$$

Resolviendo las expresiones (1.2.62) y (1.2.63) por el método de aproximaciones sucesivas para el caso de campo magnético débil,queda

$$\chi_{n} = - \frac{e^{\frac{1}{2}t_{n}t_{n}}}{m_{n}^{*}} \left\{ E + \frac{e^{\frac{1}{2}t_{n}t_{n}}}{m_{n}^{*}} \left[\hat{B} E \right] \right\}, \quad (1.2.64)$$

У

$$\chi_{p} = \frac{e \hbar \gamma_{p}(R)}{m_{p}^{*}} \left\{ E - \frac{e \tau_{p}(\vec{k})}{m_{p}^{*}} [BE] \right\}. \quad (1.2.65)$$

Para el caso de la componente electrónica, con las relaciones (1.2.58) y (1.2.64), la densidad de corriente 🔓 es

$$\hat{J}_{n} = -\frac{e^{2} h^{2}}{4 \pi^{3} m_{n}^{2}} \int_{v} \frac{\partial f_{0}}{\partial \varepsilon} \left\{ \tau_{n}(\kappa)(\hat{\kappa}\varepsilon) + \frac{\varepsilon \tau_{n}(\kappa)}{m_{n}^{4}} \kappa[\tilde{\varepsilon}\varepsilon] \right\} \hat{\kappa} dv_{\kappa} . \quad (1.2.66)$$

Si fo es la función de distribución de Boltzmann, entonces

$$\frac{\partial f_o}{\partial \epsilon} = -\frac{N}{N_{cKT}} e^{-\frac{\epsilon}{KT}}, \qquad (1.2.67)$$

y la relación (1.2.66), después de algún trabajo algebraico, que da $\hat{f}_{n} = \frac{e^{2}n}{m_{n}^{2}} E \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} (k) a^{3/2} E^{-\frac{2}{3}} da + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{3/2}} [BE] \frac{4}{3\sqrt{\pi}} [BE] \frac{4}{3\sqrt$

ya que

$$\langle \tau_{n}(k) \rangle = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{0}^{\infty} \tau_{n}(k) d^{2}e^{-d}d , \qquad (1.2.69)$$

y el valor medio del cuadrado del tiempo de relajación es

$$\langle \Upsilon_{n}^{2}|k\rangle \rangle = \frac{4}{3\sqrt{\pi}} \int_{0}^{\infty} \Upsilon_{n}^{2}(k) \, d^{2}e^{-d} \, dd ; \qquad (1.2.70)$$

se obtiene para la densidad de corriente electrónica

$$\hat{J}_{n} = \frac{e^{2}n}{m_{n}^{2}} E \langle \tau_{n}(k) \rangle + \frac{e^{3}n}{m_{n}^{2}} [E] \langle \tau_{n}^{2}(k) \rangle . \quad (1.2.71)$$

Tomendo $\mathcal{U} = \frac{e \langle \forall u | k \rangle \rangle}{m_u^{\#}}$, la relación (1.2.71) se expresa co

mo

$$\hat{J}_{n} = en \mu_{n} e + \frac{\langle \mathcal{X}_{u}^{2}(\mu) \rangle}{|\langle \mathcal{X}_{u}(\mu) \rangle|^{2}} en \mu_{n}^{2} [\hat{B}E]$$
 (1.2.72)

Ahora bien, si se define

$$r_{n} = \frac{\langle \Upsilon_{n}^{2}(k) \rangle}{|\langle \Upsilon_{n}(k) \rangle|^{2}}$$
 (1.2.73)

- 30 -

entonces la relación (1.2.72) queda como

$$\int_{n} = en \mu_{n} E + r_{n} en \mu_{n}^{2} [BE]$$
 (1.2.74)

De manera análoga, la densidad de corriente por huecos, se puede expresar como

$$\hat{j}_{p} = e P \mathcal{M}_{p} \mathcal{E} - \mathcal{V}_{p} e P \mathcal{M}_{p}^{2} [\hat{B} \mathcal{E}] , \qquad (1.2.75)$$

donde

$$r_{p} = \frac{\langle \gamma_{p}^{2}(\kappa) \rangle}{|\langle \gamma_{p}(\kappa) \rangle|^{2}}; \qquad (1.2.76)$$

por lo cual, la densidad de corriente total 3 es

$$\hat{g} = e(P\mu_{\phi} + n\mu_{\mu})E - Y_{\mu}e(\frac{Y_{\phi}}{Y_{\mu}}P\mu_{\phi}^{2} - n\mu_{\mu}^{2})(BE) . \qquad (1.2.77)$$

Para el caso de cualquier mecanismo de dispersión elástica, se tiene k=k' y E=E' y entonces

$$\frac{r_{p}}{r_{u}} = \frac{\langle \tau_{p}^{2}(u) \rangle |\tau_{u}(u) \rangle |^{2}}{\langle \tau_{u}^{2}(u) \rangle |\tau_{p}(u) \rangle |^{2}} = \frac{1}{2} . \qquad (1.2.78)$$

Si $v_n = v$ y considerando dispersiones elásticas, se tiene que

$$j = e(PM_{*} + MM_{*})E - re(PM_{*} - MM_{*})[BE]$$
 (1.2.79)

Ahora, si se supone que la corriente eléctrica esté dirigida a lo largo del eje "x", o sea que $\dot{j} = \dot{j}_x$ y $\dot{j}_y = \dot{j}_z = 0$;

- 31 -
y el campo magnético \hat{B} está en la dirección "z", es decir, -B=B_z y B_x=B_y= 0, entonces la densidad de corriente eléctrica (1.2.79) se puede dar en términos de sus componentes como

$$j_{x} = e(P\mu_{y} + n\mu_{y})E_{x} + re(P\mu_{y}^{2} - n\mu_{y}^{2})BE_{y} = j_{y}$$
 (1.2.80)

$$j_{y} = e(p\mu_{p} + n\mu_{n})e_{y} - re(p\mu_{p}^{2} - n\mu_{n}^{2})Be_{x} = 0$$
, (1.2.81)

Resolviendo (1.2.80) y (1.2.81) para Ey, , se obtiene

$$E_y = \frac{r}{e} \frac{P\mu_{e}^{2} - n\mu_{u}^{2}}{(P\mu_{e} + n\mu_{u})^{2}} \dot{J}B = R\dot{J}B$$
, (1.2.82)

donde el coeficiente de Hall R es

$$R = \frac{r}{e} \frac{P \mu_{o}^{2} - n \mu_{n}^{2}}{(P \mu_{p} + n \mu_{n})^{2}}, \qquad (1.2.83)$$

por lo que el coeficiente de Hall depende del mecanismo de dis persión, que se considera en el factor 🗸 .

Para dispersión por iones de impureza, se tiene⁽⁸⁾ que el factor v está dado por

$$Y = \frac{316 T}{512} \approx 1.93 \qquad (1.2.84)$$

Y para dispersión fonónica⁽⁸⁾ (oscilaciones acústicas de la red)

- 32 -

el factor ¥ que se tiene es

$$r = \frac{3\pi}{8} \approx 1.18$$
 (1.2.85)

La dispersión depende de la temperatura, por lo que al de terminar el coeficiente de Hall, hay que ver cuál es el mecanismo de dispersión dominante ⁽⁸⁾; para bajas temperaturas el meca nismo dominante de dispersión es generalmente por iones de impureza, por lo que se debe tomar $Y = \frac{305 \, 4}{512}$; para temperaturas altas ($T \approx 300 \text{ K}$), el mecanismo de dispersión dominante es por fono nes, por lo que $Y = \frac{317}{5}$; a temperaturas a las cuales los dos mecanismos de dispersión son importantes, es factor Y es más complejo.

En este trabajo, se considera que el efecto dominante de dispersión es por fonones, por lo que se tomará $x = \frac{2\pi}{8}$. Como se trata de un semiconductor tipo p, el coeficiente de Hall ex presado por la relación (1.2.83), ya que la concentración de e lectrones n es mucho menor que la concentración de huecos, sereduce a

$$R = r \frac{1}{ep} \qquad (1.2.86)$$

Con la conductividad $\sigma = e \rho \mu_{\perp}$ de la muestra, en base a la re lación (1.2.86), se tiene

$$\frac{1}{12.87}$$
; (1.2.87)

- 33 -

comparando esta relación con la del campo magnético débil⁽⁸⁾

$$|\mathbf{R}|_{\mathbf{T}} = \mu_{\mathbf{H}} \tag{1.2.88}$$

donde μ_u es la movilidad Hall, se obtiene

$$\mu_{\mu} = r_{\mu_{a}}$$
 (1.2.89)

Cuando el tiempo de relajación es independiente de la energía, v=1 y por tanto

$$\mathcal{M}_{\mu} = \mathcal{M}_{\lambda} \tag{1.2.90}$$

que ocurre en metales y semiconductores degenerados.

En este trabajo, donde se trata con un semiconductor no degenerado con $\gamma = \frac{3\pi}{5}$, la movilidad Hall se relaciona con la movilidad de deriva mediante la expresión

$$\mathcal{M}_{\mu} = \frac{3\pi}{8} \mathcal{M}_{\perp} \qquad (1.2.91)$$

y el coeficiente de Hall es

$$R = \frac{3\pi}{8} \frac{1}{e\rho} \qquad (1.2.92)$$

Por otro lado, la conductividad $\mathbf{C} = e \mathcal{P} \mathcal{U}_{\mathcal{P}}$ del semicon ductor depende de la temperatura, ya que la movilidad de los por tadores de carga está en relación con el tiempo de relajación, que a su vez depende del mecanismo de dispersión donde la temperatura es el factor determinante. 1.3 Coeficiente de absorción y brecha energética.

Otros parámetros importantes en la caracterización de un se miconductor, son el coeficiente de absorción \checkmark y la brecha e nergética E_g. En esta sección se definirán dichos parámetros.

Considérese un haz de radiación electromagnética que incide en un material. La intensidad de la radiación que traspasa el ma merial I_t disminuye debido a la reflexión y absorción en éste. Cuando la intensidad de luz I_t incide en una capa de espesor dx, la intensidad de la radiación disminuye en una cantidad -dI_t que es absorbida por el material y es proporcional a la cantidad de energía incidente y al espesor de la capa absorbente, esto es $- dI_t = \ll I_t d_X$ (1.3.1)

donde el factor de proporcionalidad \checkmark es el llamado coeficiente de absorción, que expresa la cantidad de energía absorbida de un haz de intensidad unidad por una capa de espesor unidad. Si la reflexión se considera despreciable y la intensidad del haz incidente en el material es I_0 , de la relación (l.3.1) se ob-tiene la intensidad de la luz transmitida en un material de espe sor d, es

$$I_{1} = I_{0} e^{-4d}$$
 (1.3.2)

que se conoce como la ley de Buger-Lambert.

El coeficiente de absorción 🖌 , es una característica del

- 35 -

nedio absorbente y depende de la longitud de onda de la radia ción electromagnética incidente; a esta dependencia se le llamaespectro de absorción.

Resolviendo la correlación (1.3.2) para el coeficiente de absorción & se tiene que

$$d = -\frac{\ln \frac{T_{t}}{T_{t}}}{d} \qquad (1.3.3)$$

El coeficiente de transmisión T se define como la frac -ción de intensidad transmitida

$$T = \frac{I_4}{I_6}$$
(1.3.4)

por lo que la relación (1.3.3) queda,

$$\alpha' = -\frac{\ln T}{d} \qquad (1.3.5)$$

La absorción de la radiación en los semiconductores puede estar relacionada con la variación del estado energético de loselectrones libres o ligados a los átomos, tanto como con el cambio de la energía vibratoria de los átomos de la red; por lo que en los semiconductores⁽⁸⁾ se tienen varios tipos fundamentales de absorción óptica, de los cuales, el que interesa en este trabajo es la absorción intrínseca.

La absorción intrínseca es la que se da cuando un semicon ductor absorbe un cuanto de luz (fotón) y electrones de la banda de valencia adquieren una energía suplementaria, que es igual omayor a la brecha energética E_g , banda de energía prohibida que separa la banda de valencia de la banda de conducción, y pasan a la banda de conducción.

De acuerdo a su estructura de bandas, los semiconductores se clasifican en dos tipos; uno de ellos se tiene cuando el míni mo de energía de la banda de conducción que se caracteriza por su vector de onda \hat{k}_{min} coincide con el máximo de energía de la banda de valencia caracterizado también por su vector de onda -- \hat{k}_{mix} . Generalmente es para $\hat{k}=0$, es decir, $\hat{k}_{min}=\hat{k}_{mix}$, como se muestra en la figura (1.3.1). El otro tipo de semicondu<u>c</u> tor es en el que los extremos de las bandas de conducción y de valencia se encuentran en diferentes puntos de la zona de Brill<u>o</u> uin, esto es, $\hat{k}_{min}\neq\hat{k}_{mix}$, como es mostrado en la figura (1.3.2)

Cuando un electrón interacciona con un fotón, debido a queel vector de onda de éste $\gamma = \frac{2\pi}{\lambda_{\pm}}$ es muy pequeño en compara -ción al del electrón, se puede despreciar y el vector de onda -del electrón se conservará. Esto sirve como regla de selección para las transiciones electrónicas llamadas directas o vertica les. Las transiciones que tienen más probabilidad de producirseson entre los estados energéticos correspondientes al máximo dela banda de valencia y al mínimo de la banda de conducción.

Para analizar la absorción intrínseca debido a transiciones

- 37 -



Fig. 1.3.1 Diagrama de bandas de energía simples de un semiconductor donde $\hat{k}_{max} = \hat{k}_{max}$



Fig. 1.3.2 Estructura de -bandas de energía de un semi conductor donde k_{min} k_{man}



Pig. 1.3.3 Transiciónes directas entre bandas en un se miconductor cuyas bandas devalencia y conducción tienen simetría esférica.

- 38 -

directas entre bandas en un semiconductor cuyas bandas de valencia y de conducción tienen simetría esférica, supóngase que se producen transiciones de electrones desde un estado energético de la banda de valencia caracterizado con un vector de onda en el intervalo de k a k+dk, como se muestra en la figura (1.3.3) La energía del fotón absorbido WY, en este caso, puede ser de terminada en base a la ley de la conservación de la energía, esdecir

$$hY = E_{c}(\hat{k}) - E_{v}(\hat{k})$$
 (1.3.6)

por lo cual, la energía del fotón hy será

$$hV = \left[E_{c}(0) + \frac{t^{2} c^{2}}{2m_{x}^{2}}\right] - \left[E_{v}(0) - \frac{t^{2} c^{2}}{2m_{y}^{2}}\right] \qquad (1.3.7)$$

donde $\mathbf{m_n}$ y $\mathbf{m_p}$ son las masas efectivas del electrón y del hue co respectivamente; ya que la brecha energética $\mathbf{E_g} = \mathbf{E_c}(0) - \mathbf{E_v}(0)$ y la masa efectiva reducida del electrón y el hueco $\mathbf{m_v} = \frac{\mathbf{m_v} \cdot \mathbf{m_s}}{\mathbf{m_u} + \mathbf{m_s}}$, la energía del fotón puede ser expresada como

$$hY = E_g + \frac{h^2 k^2}{2m_r^4}$$
 (1.3.8)

El coeficiente de absorción \propto es inversamente proporcional a la longitud del recorrido medio libre del fotón ξ (que a su vez se determina por su velocidad de movimiento v_f y tiempo

- 39 -

de recorrido medio libre γ_{f}), esto es .

$$d = \frac{1}{1_{1}} = \frac{1}{\tau_{1} \, \sigma_{c}} \, . \qquad (1.3.9)$$

Si la probabilidad de absorción del fotón por unidad de tiempo es $q_{\epsilon}(v) = \frac{1}{\tau_{\epsilon}}$ y la velocidad $v_{\epsilon} = \frac{c}{\tau_{\epsilon}}$, con c la velocidad de la luz en el vacío y τ el índice de refracción de la sustancia el coeficiente de absorción dada por (1.3.9) puede ser expresado como

$$d = q(r) \frac{n}{c}$$
 (1.3.10)

La probabilidad de absorción de un cuanto de luz con energía enel intervalo de hV a h(V+dV), según se ilustra en la figura (1.3.3), es proporcional a la probabilidad de transición del e lectrón P(V) y el número de estados cuánticos en la banda de valencia N (E') en el intervalo de energías de $-E_g - E'$ a $-E_g - E' - dE'$, esto es,

$$g(v) dv = x P(v) N(E') dE'$$
, (1.3.11)

donde el factor dos se tiene por las dos posibles polarizaciones de la luz.

Se sabe que la densidad de estados cuánticos en la banda de valencia está dada por⁽⁸⁾

$$N(E') = \frac{4\pi(2mp)^{2}}{h^{3}} E'^{\frac{1}{2}}$$
(1.3.12)

- 40 -

7

por lo que la relación (1.3.11) se puede expresar como

$$g(v)dv = \frac{BT}{h^3} (2M_p^*)^{3/2} p(v) E^{1/2};$$
 (1.3.13)

ahora, ya que $E' = \frac{\pi^2 \kappa^2}{2 m_p^2}$ y con la relación (l.3.8), se tie-

$$g(r) = \frac{2}{\pi^2} \kappa^2 \frac{d\kappa}{d\nu} = \frac{2(2m_r^2)^{3/2}}{\pi \pi^2} p(r) (hv - E_g)^{1/2} . \quad (1.3.14)$$

La probabilidad de transición p(V) es prácticamente constanteen las transiciones directas permitidas⁽⁸⁾ cuando $\hat{k} = 0$, por lo que el coeficiente de absorción para este tipo de transicio-nes «] se puede escribir en base a las relaciones (1.3.10) y (1.3.14), para un intervalo limitado de variación $h_V = E_{\phi}$, como $\alpha_{\downarrow} = B(h_V - E_{\phi})^{\mu_c}$, (1.3.15)

donde $B = \frac{z\bar{u}(zw_{\tau}^{2})^{3/2}}{c\pi t_{1}^{2}} p(V)$ tiene un valor prácticamente constante.

La gráfica de la relación (1.3.15) se muestra en la figura-(1.3.4), donde se observa una parte lineal en un intervalo de h_{J} la cual al prolongarse hasta el eje de las abscisas permite de terminar la brecha energética E_g .

Existe otra contribución al coeficiente de absorción en las transiciones directas en donde la probabilidad de transición P(V)

- 41 -

es proporcional a k², por lo que el coeficiente de absorción---«' debido a estas transiciones llamadas prohibidas, ya que su magnitud es muy pequeña en comparación con las transiciones di rectas permitidas, será de la forma

$$('_{d} = c(hv - E_{g})^{3/2}, (1.3.16)$$

donde C es una constante. Los valores típicos⁽¹⁰⁾ para el coef<u>i</u> ciente de absorción son: para transiciones directas permitidas – de $A_d = 6.7 \times 10^3 \text{ cm}^{-1}$ con hw - Eg = 0.01 eV; y para las transiciones directas prohibidas de $A'_d = 4.5 \text{ cm}^{-1}$ con hw - Eg = 0.01 eV.

Otro tipo de absorción intrínseca se tiene en transicionesindirectas o no verticales, en las cuales el vector de onda \hat{k} del electrón no se conserva como en las transiciones directas,-véase figura (1.3.5), aunque se sigue conservando el casi impulso en el proceso, pues el electrón además de interactuar con la radiación electromagnética, interactúa con las oscilaciones de la red, es decir, las transiciones indirectas se producen con la emisión o absorción de un fonón.

El coeficiente de absorción para las transiciones indirec tas A_i , se compone de dos términos, A_a y A_e , relacionados -con la absorción y emisión de un fonón respectivamente, es decir

 $d_i = d_a + d_e$ (1.3.17)

- 42 -



Fig. 1.3.4 Gráfica de la rela ción 1.3.17. Nótese que la ex trapolación de la porción recta al eje w da la brecha ener gética E_g .



Fig. 1.3.5 Diagrama que repre senta las transiciones indirec tas en las cuales el vector de onda no se conserva.



Fig. 1.3.6 Dependencia de «⁴⁶ en función de hy para transi ciones indirectas; A correspon de a transiciones con emisiónfonónica y B con absorción fonónica.

- 43 -

La condición para que se produzca una transición con absorción o emisión de un fonón de energía E_p es $hv > E_g + E_p$, donde el signo negativo es para la absorción y el signo positivo parala emisión.

El término de la absorción para transiciones indirectas con absorción de un fonón a_{α} , de energía E_{p} es⁽⁸⁾

$$d_{A} = \frac{B(hv - E_{g} + E_{p})^{2}}{e^{\frac{E_{p}}{MT}} - 1}, \quad (1.3.18)$$

con $hy > E_g - E_F$ y $d_a = o$ para $hy < E_g - E_F$, donde B es unafunción que varía lentamente con la frecuencia \vee . El términode la absorción con emisión de un fonón d_e es⁽⁸⁾

$$d_{e} = \frac{B(h V - E_{g} - E_{p})^{2}}{1 - e^{-\frac{Ky}{KT}}}$$
(1.3.19)

con hysegter y de=o para hyzegter.

En la figura (1.3.6), se muestra la gráfica de $A_{i}^{\prime \epsilon}$, donde se observa que se tienen dos porciones rectilineas. La recta-A corresponde a las transiciones con emisión fonónica que se -corta al prolongarla al èje de las abscisar en el punto $hV = E_{j} + F_{i}$; y la recta B corresponde a las transiciones con absorción fonón<u>i</u> ca que se intersecta en el eje de las abscisar en el punto --- $hV = E_{j} - E_{p}$. El punto medio entre las intersecciones es $hV = E_{g}$. 1.4 Preparación del subestrato semiconductor Cu₂0.

En esta sección se describe la elaboración del subestrato semiconductor Cu₂O que se utilizará en la fabricación de las ce<u>l</u> das fotovoltaicas, del que se hará su caracterización en la sección siguiente.

El subestrato semiconductor se obtiene por la oxidación da-

Se utilizaron láminas de cobre grado metalúrgico con dimensiones l.5 x l.5 x 0.05 cm. La limpieza de las láminas se hizo mediante ataque químico, introduciendo dichas láminas en voa solu ción diluida de HNO₃ al 25 % durante algunos segundos, complemen tándose con aplicación de acetona.

Una vez que se tienen las láminas de cobre limpias, se in troducen a un horno marca Lindberg modelo 51848, con una incent<u>i</u> dumbre de \pm 5 °C, para su calentamiento como se muestra en la figura (1.4.1). Las etapas seguidas en este proceso son las rec<u>o</u> mendadar en el trabajo de A. Sánchez J.⁽⁵⁾ y S. López R.⁽⁶⁾, que son:

A.- Tres horas a una temperatura de 950 °C.
B.- Siete horas a una temperatura de 1030 °C.
C.- Cuarenta y cinco minutos disminuyendo la temperatura lentamente de 1030 °C a 500 °C.

D.- Choque térmico en agua milipore a temperatura ambiente.

Las temperaturas citadas están dentro del intervalo de temperaturas a las cuales existe es Cu_2O ⁽¹¹⁾ que va de aproximada mente 375 ^oC a 1230 ^oC , el choque térmico se hace con la final<u>i</u> dad de evitar se siga formando óxido cúprico CuO, que es aislante y deberá removerse.

La composición de la muestra después del calentaniento es la observada en la figura (1.4.2), en la que se tiene una partecentral de óxido cuproso Cu₂O rodeada de una capa de CuO.

Para remover la capa de óxido cúprico y dejar sólo el subes trato semiconductor de óxido cuproso Cu₂O, las muestras son atacadas con una solución de cianuro de potasio (KCN)al 20 % durante una hora. El subestrato queda ya listo para ser utilizado enlas medidas de los parámetros que se harán para caracterizarlo y para la elaboración de las celdas fotovoltaicas. La figura -- -(1.4.3) muestra la topografía de la muestra después del calentamiento en el horno y las figuras (1.4.4) y (1.4.5) la topografía del subestrato semiconductor Cu₂O como queda finalmente.

Según se observa en la figura (1.4.3) antes de ser removida la capa de CuO, las fronteras de grano del subestrato semicon ductor se delinean bien sobre la capa de óxido cúprico, antici pando el tamaño de grano formado en el subestrato Cu₂O.

- 46 _





Fig. 1.4.1 Diagrama del horno utilizado en la oxidación de las muestras de Cu para obte ner el subestrato semiconduc tor Cu₂O. Fig. 1.4.2 Sequema de un cor te transversal de la muestrade Cu después de la oxidación en el horno.



Fig. 1.4.3 Fotografía del plano de la amestra de Cu después de la oxidación en el horno.



Fig. 1.4.4 Fotografía del plano de la muestra de -Cu₂0.



Fig. 1.4.5 Fotografía de un corte transversal de la muestra de Cu₂0.

La figura (1.4.4) muestra claramente las fronteras de grano del subestrato Cu_20 . El tamaño de grano formado oscila desde 0.5 hasta 10 mm. El corte transversal de la figura (1.4.5) muestra que el grano prácticamente abarca todo el grosor de la muestra,no observándose interfase. El subestrato Cu₂0 se observa transl<u>ú</u> cido con su color característico rojo rubí, el grosor obtenido es de 0.045 cm.

El tamaño de grano promedio del subestrato varía mucho de <u>u</u> na muestra a otra y se cree que es debido a la historia del mat<u>e</u> rial utilizado.

1.5 Caracterización del subestrato semiconductor Cu₂O.

Los aspectos que interesan del subestrato semiconductor eneste trabajo son su comportamiento eléctrico y su comportamiento óptico, es decir, sus propiedades electricas y ópticas.

Dentro de las propiedades eléctricas, se tiene interés en determinar los parámetros más importantes para su aplicación enceldas fotovoltaicas, esto es, su conductividad eléctrica σ , la concentración y tipo de portadores y la movilidad μ de éstos.

Se examinará en primer término el aspecto eléctrico. Para la medida de la conductividad 4 del subestrato semiconductor, -

- 49 -

se mide su resistencia eléctrica R , a partir de ésta, se obtiene la resistividad d de la muestra y finalmente la conduct<u>i</u> vidad, haciendo un tratamiento estadístico.

La resistencia eléctrica R es el inverso de la pendiente de las rectas de la figura (1.5.2). La resistividad of está da da por

$$f = R \frac{1}{1}, \qquad (1.5.1)$$

donde A es la sección transversal por la que circula la co --rriente y l es la longitud del material donde se considera laresistencia. La conductividad T se define como el inverso dela resistividad, es decir

$$\sigma = \frac{1}{2}$$
 (1.5.2)

En el subestrato semiconductor se depositaron por evaporación al vacío cuatro franjas de oro como contactos eléctricos en una cara y en la otra una película en toda la superficie.

Las medidas de la resistencia para obtener la conductivi dad de la muestra sólo se hicieron en el sentido transversal al plano del subestrato, ya que dada su morfología permite asumirque el valor obtenido para la conductividad en el sentido trans versal G_{τ} será una cota superior al valor que se pueda obtener para este parámetro en el plano del subestrato.

Para las medidas de la resistencia R_T en el sentido trans-

-50-

versal al plano de la muestra, en las regiones de la segunda ytercera franjas, se utilizó el circuito mostrado en la figura -(1.5.1). Se empleó una fuente de voltaje d.c. variable Hewlett-Packard 6111 A y un multímetro digital Fluke para la medida dela corriente I_T .

La dependencia de la corriente I_T con respecto al voltajeaplicado V_T , típica a las cinco muestras analizadas, se observa en la gráfica de la figura (1.5.2). En la tabla (1.5.1) se dan los valores de R_T de cada una de las muestras y también los valores de la resistividad \mathcal{P}_T y conductividad \mathcal{T}_T en el sentido transversal calculados con las relaciones (1.5.1) y (1.5.2).

Como se observa en los datos registrados en la tabla ----(1.5.1), las resistencias y por lo tanto la resistividad y conductividad, difieren notablemente para diferentes regiones de la muestra y también de una muestra a otra, por lo que se puede afirmar que el subestrato semiconductor es bastante heteroge -neo; esto se debe posiblemente a la manera en que se fabrican las láminas de cobre grado metalúrgico utilizadas en la elabora ción del subestrato semiconductor Gu_2O , en los que el tamaño --del grano, como se observó en la sección anterior, es muy varia ble. Dada la heterogenidad del subestrato semiconductor Gu_2O --no se hará un análisis preciso de las incertidumbres de los pa-

-51-



Fig. 1.5.1 Circuito utilizado en las medidas dela resistencia en sentido transversal en la regio nes de la 2^{\pm} y 3^{\pm} franjas.



Fig. 1.5.2 Dependencia experimental de la corriente I_T Vs. V_Ten dirección transversal al plano de la muestra M1 en las regio nes 2^a y 3^a franjas. rámetros anteriores (que son del orden de 10 %) y se tomará como valor representativo de la conductividad V en el sentido transversal al plano del subestrato el orden de magnitud del -promedio, que es

$$\sigma = 10^{-5} (\text{ohm-cm})^{-1}$$
 (1.5.3)

Ahora se determinará la concentración y tipo de portado -res, como se explicó anteriormente, a partir de medidas del vo<u>l</u> taje de Hall V_H y a través del coeficiente de Hall R_H dado porla relación (1.2.92) en la que se toma en cuenta el mecanismo dominante en la dispersión de portadores, que en este caso es por fonones.

$$R_{\mu} = \frac{3\pi}{B} \frac{1}{ep}$$
 (1.5.4)

El campo magnético de Hall \in_{W} está relacionado con la densidad de corriente y el campo magnético \oplus por la relación (1.2.82),es decir,

$$E_{\mu} = R_{\mu} \dot{A} B$$
, (1.5.5)

que se puede escribir como:

$$V_{H} = R_{H} \frac{B}{8} I_{c}$$
, (1.5.6)

donde el voltaje de Hall es $V_{H} = \mathcal{E}_{H}d$, g es el grueso de la -muestra e I_c es la corriente que se pasa a través del material,

- 53 -

Para hacer las medidas del voltaje de Hall se evaporaron en el subestrato semiconductor Cu₂O cuatro contactos óhmicos de Au como se muestra en la figura (1.5.3) y se soldaron hilos de co bre con pintura de plata para hacer las conexiones necesarias. -El subestrato se colocó en un campo magnético perpendicular al plano del subestrato, generado por un electroimán marca Cenco mo delo 79637-77, alimentado con una fuente de potencia Super Mercu ry; el campo magnético se midió con un gaussmetro Bel 240. El -circuito utilizado en las medidas del voltaje de Hall es el mostrado en la figura (1.5.4).

La corriente de control I_c se midió con un multímetro Uni gor 15, que se varió a través del voltaje de control V_c aplicado con una fuente Hewlett Packard 6215 A. El voltaje de Hall V_H esla diferencia entre el voltaje perpendicular a I_c con campo magnético de tres kilogauss y sin campo para eliminar los efectos óhmicos, medidos con un electrómetro digital Keithley 616.

La gráfica de la figura (1.5.5) muestra la dependencia delvoltaje de Hall $V_{\rm H}$ con respecto a la corriente de control aplicada $I_{\rm C}$, típica a las muestras analizadas. De los datos de lafigura (1.5.5) se obtiene a través de la relación (1.5.6) el co<u>e</u> ficiente de Hall $R_{\rm H}$. De la polaridad observada se determinó que los portadores mayoritarios son positivos (huecos), por lo -

- 54 -



Pig. 1.5.3 Se muestra en este diagrama los cuatro contac - tos óhmicos evaporados y los hilos de cobre soldados con -- pintura de plata para hacer las medidas del efecto Hall en-las muestras de Cu_20 .



Fig. 1.5.4 Diagrama del circuito utilizado en la medidasdel voltaje Hall. El campo magnético É es perpendicularal plano de la muestra.

TABLA 1.5.1

Resultados obtenidos de las resistencias K, resistividades V y conductividades V en el sentido transver sal para cada una de las cinco muestras de Cu₂O analiradas. Los índices 2 y 3 denotan las regiones de la 2a y 3a franjas, respectivamente.

| - | at [idan] | ef [odma] | 4.2 12 | +; ; | 4: - Tidan | . . |
|------------|--------------|--------------|-----------|---------|---------------|----------------|
| 101 | 4.9 | 2.8 | 2.0 | 1.2 | 4.8 | 8.4 |
| M 2 | 274 | 1000 | 112 | 411 | 0.09 | 0.02 |
| #3 | 6.6 | 5.3 | 2.7 | 2.2 | 3.7 | 4.5 |
| X 4 | 1.0 | 85 | 0.43 | 35 | 23 | 0.3 |
| 115 | 12 | | 5.0 | | 2.0 | |



Fig. 1.5.5 Puntos experimentales del voltaje Hall respecto de la corriente de control T_e de los cuales se obtiene el coefi ciente Hall R_M .

- 56 -

que el semiconductor Cu₂O es del tipo p . El valor del coefi ciente de Hall encontrado es:

$$R_{\mu} = 8 \times 10^{5} [c^{-1} cm^{3}]$$
, (1.5.7)

con este valor de R_H, se obtiene la concentración de p de -los portadores de carga de la relación (1.5.4); el valor determinado es

$$P = 9 \times 10^{12} [cm^{-3}]$$
 (1.5.8)

Con los valores encontrados para la conductividad eléctrica c de las muestras y su concentración p, dadas en (1.5.3)y (1.5.8), se puede obtener la movilidad de los portadores de carga por medio de la relación

El valor que se obtiene para la movilidad, trabajando con órde nes de magnitud dada la heterogenidad de la muestra es

$$\mathcal{M} = 10 \left[\frac{em^2}{V-s} \right] . \qquad (1.5.10)$$

El otro aspecto que interesa en este trabajo, es el compor tamiento óptico del subestrato semiconductor Cu_2O en el que serefiere a su espectro de absorción, su acoplamiento al espectro de emisión solar y la determinación de la brecha energética E_g a partir de las medidas de la transmisión óptica de la muestra, parámetro muy importante en el funcionamiento de una celda so lar.

- 57 -

Para obtener el espectro de transmisión del subestrato semiconductor $\operatorname{Cu}_2 0$, así como la dependencia del coeficiente de ab sorción respecto de la longitud de onda λ de la luz inciden te, $\operatorname{cl}(\lambda)$, las muestras se adelgazaron hasta un espesor de ---0.025 cm atacándolas con una solución de NH₄Cl por algunos minu tos. El espectro de transmisión se obtuvo mediante un espectrómetro Perkin Elmer 330 de doble haz, en uno de los cuales se co locó el subestrato Cu₂0 sobre una placa de vidrio y en el otrohaz se colocó una placa del mismo vidrio, para compensar la reflexión y la absorción debida a dichas placas.

La figura (1.5.6) muestra la gráfica de la fracción deintensidad luminosa transmitida (coeficiente de transmisión) en el subestrato semiconductor Cu₂O dependiendo de la longitud deonda de la luz incidente.

El espectro de absorción $A(\lambda)$ se determina con los datos de la gráfica de la figura (l.5.6) a partir de la relación (l.3.5), ya que la reflexión del subestrato Cu_pO es pequeño, esto es

$$\alpha' = -\frac{\ln T}{d} \qquad (1.5.11)$$

En la figura (1.5.7) se muestran la absorción típica del subestrato semiconductor Cu₂O analizado y el espectro de emi -sión solar. Se observa que el acoplamiento entre los dos espec-

- 58-



Fig. 1.5.6 Transmisión de intensidad luminosa como función dela longitud de onda obtenida para un subestrato semiconductor – Cu_2O .



Fig. 1.5.7 Espectro de absorción de subestrato semiconductor yespectro de emisión solar AML. Nótese que se tiene un acoplamien to aceptable de los dos espectros.

- 59 -

tros es bueno, ya que una gran parte de la región de longitudes de onda donde el sol más emite, el subestrato semiconductor absorbe mejor.

La gráfica de la figura (1.5.8) muestra dependencia de \checkmark^2 con respecto a la energía de los fotones incidentes. En esta – gráfica se observa que se tiene absorción intrínseca con transmiciones directas, como se explicó en la sección 1.3, donde el coeficiente de absorción está dado por la relación (1.3.15),

$$d_d = B(hv - E_g)^{k_2}$$

Prolongando la parte lineal de la gráfica hasta intersec tarse con el eje de energía del fotón, se determina el valor de la brecha energética E_g . El valor que se obtiene, considerando un error involucrado del 10 al 15 %, es

 $\mathbf{E}_{\mathbf{g}} = 2$

- 60 -



Fig. 1.5.8 Dependencia experimental de d^2 respecto a la <u>e</u> nergía de los fotones incidentes que muestra absorción in -trínseca con transiciones directas en Cu₂O. 1.6 Discusión y conclusiones.

En el desarrollo de la sección 1.2 se observa que la incor poración de la distribución estadística de velocidades de los portadores de carga en la ecuación cinética de Boltzmann, traecomo consecuencia que el tiempo de relajación γ de éstos depen da de su energía a través del vector de onda \hat{k} , y por lo tanto también su movilidad. El coeficiente de Hall depende del mecanismo de dispersión dominante de los portadores de carga conel factor ν , que para la temperatura ambiente en la que se -trabajó (300 K) es dispersión fonónica⁽⁸⁾.

La preparación del subestrato semiconductor Gu_2^0 se llevóa cabo oxidando láminas de cobre grado metalúrgico de l.5 x l.5 x 0.05 cm por calentamiento a 1050 °C en atmósfera normal, procedimiento que es muy simple y de bajo costo, que produce muestras de Gu_2^0 con estructura columnar y tamaño de grano mayor -que el grosor del subestrato. El tamaño de grano (de 0.5 a 10 mm) difiere bastante de una muestra a otra, que es debido sin-duda, a la historia del material utilizado en la elaboración -del subestrato.

Es notable el hecho de que la conductividad del subestrato Cu_2^0 , en sentido transversal, haya sido bastante diferente de <u>u</u> na región a otra de la muestra y también para diferentes mues -

- 62 -

tras, esto es, los subestratos obtenidos son muy heterogeneos.

La conductividad representativa del subestrato es del orden de 10⁻⁶(ohm-cm)⁻¹, cuyo valor está de acuerdo con las reportadas^{1.2} Sobre esto hay que destacar el hecho de que se trabajo con muestras policristalinas cuya materia prima es cobre grado metalúr<u>gi</u> co (comercial) que no es de alta pureza (98-99 %) y sobre el ---cual no se tiene control. Para obtener buena reproductibilidad de resultados en trabajos posteriores será recomendable utilizar cobre de mayor pureza, con el que se obtengan subestratos poli cristalinos con tamaño de grano más uniforme y menos imperfeccio nes cristalinas.

De las medidas Hall se tiene que el subestrato Cu₂O es un semiconductor tipo p cuya concentración de huecos es del orden de 10¹⁰ cm⁻³. Estos datos concuerdan con los valores reportados -(13,14)

La movilidad de los portadores de carga determinada es delorden de 10 cm/V-s .

Los valores encontrados de la conductividad en los subestr<u>a</u> tos Cu₂O analizados son bajos (dada la pequeña concentración de portadores mayoritarios y su movilidad) para su aplicación en --celdas fotovoltaicas, por lo que sería conveniente introducir im purezas apropiadas al Cu₂O -como Cd⁽¹²⁾- para aumentar la conce<u>n</u>

- 63 -

tración de portadores mayoritarios, además de refinar la tecnica de preparación del subestrato (temperaturas y tiempos de recocido) para que el semiconductor tenga menos imperfecciones cristalinas y se incremente la movilidad de los portadores de carga aumentando así la conductividad eléctrica de la muestra.

El valor de la brecha energética determinada del Cu_2O es del orden de 2 eV. y la absorción de la radiación se lleva a ca bo mediante transiciones directas. Esto concuerda con los datos reportados en la literatura (4,12,13). El espectro de absorcióndel subestrato semiconductor Cu_2O se acopla aceptablemente al espectro de emisión solar en condiciones AMI, que es lo impor tante para su aplicación en fotoceldas de uso terrestre. Estascaracterísticas, además del bajo costo de elaboración del sub estrato semiconductor Cu_2O , lo hace atractivo para su aplica -ción en celdas solares.

La caracterización del subestrato semiconductor hecha en el desarrollo de este capítulo logra uno de los objetivos principales que se mencionaron en la introducción al presente traba jo y cubre un aspecto importante en el estudio de las celdas so lares que no se había hecho en los trabajos anteriores (5,6,7).

- 64 -

CAPITULO SEGUNDO

UNIONES Y CELDAS SOLARES DE BARRERA SCHOTTKY.

2.1 Introducción.

Las celdas solares -fotovoltaicas- son dispositivos que tie nen la proviedad de transformar directamente la luz que recibenen energía eléctrica, a través del fenómeno llamado efecto fotovoltaico. Uno de los principales aspectos en la elaboración de <u>u</u> na cada fotovoltaica son los contactos eléctricos, que en general se clasifican en dos tipos: óhmicos y rectificadores. Estosdos tipos de contactos se utilizan en las celdas solares, el rec tificador para la separación de los portadores de carga fotogene rados y el óhmico para su recolección.

Los contactos óhmicos tienen como característica que su relación corriente-voltaje es lineal, no importando la polaridad <u>a</u> plicada, mientras que en los contactos rectificadores dicha rel<u>a</u> ción no es lineal y la polaridad aplicada es importante, ya queen un sentido pueden conducir fácilmente la corriente eléctricaen tanto que en el otro sentido, no.

Los diferentes tipos de uniones, se pueden clasificar en ge neral, como homouniones, heterouniones y uniones de barrera ---Schottky. En las secciones siguientes se explicará en detalle ca

- 65 -

da uno de estos tipos.

El funcionamiento y las características de las celdas fotovoltaicas se analizarán en el desarrollo de este capítulo, así como la caracterización de las celdas elaboradas, motivo de este trabajo.

2.2 Homouniones, heterouniones y uniones de barrera Schottky.

Las homouniones, son uniones del mismo material semiconductor pero de diferente tipo de conductividad, es decir, uniones en las que uno de los componentes es un material A semiconductor tipo n y el otro componente de la unión es también el material A semiconductor pero tipo p. Ejemplos típicos de este t<u>i</u> po de uniones son n-p Ge y n-p Si.

Se considerará la formación de una homounión ideal. Se tienen los dos semiconductores p y n separados una distan cia d, grande, de manera que no hay interacción entre los portadores de carga superficiales, como se muestra en la figura --(2.2.1). Al instante de hacerse el contacto entre los dos mate-riales semiconductores, existe una concentración uniforme n_{n_0} de electrones, así como p_{n_0} de huecos libres de moverse en el material semiconductor tipo n extendiéndose hasta la superficie de contacto - unión- y sobre el semiconductor tipo p una con centración de huecos p_{n_0} y n_{p_0} de electrones libres de moverse ex-

- 66 -

tendiéndose hasta dicha unión. Como la concentración de nn. de electrones es mucho mayor que la concentración n po de electrones, al momento de formarse la unión, existe un enorme gradiente de concentración entre las dos regiones. Lo mismo se tiene con respecto a las concentraciones de huecos pe y pe en la unión Esos enormes gradientes de concentración crean una corriente dedifusión de electrones del semiconductor tipo n a la región p y una corriente de difusión de huecos de la región p a la región n, dejando una deficiencia de portadores mayoritarios cer ca de la unión, región de carga espacial. El flujo difusional no sigue indefinidamente, ya que en la región de deficiencia de por tadores mayoritarios se tienen iones positivos y negativos sin compensar en el lado n y p, respectivamente, generándose así un campo eléctrico $\hat{\epsilon}$ que se opone a los flujos difusionales tanto de electrones como de huecos hasta alcanzar el equilibriotermodinámico⁽¹⁵⁾, esta situación se ilustra en la figura (2.2.2)

El diagrama de bandas de energía en la región del contactode la homounión se observa en la figura (2.2.3), en la que se aprecia la formación de una barrera de energía potencial de con tacto $e \varphi_0$. Nótese que el nivel de Fermi F_f es el mismo en t<u>o</u> do el sistema, ya que éste se encuentra en equilibrio termodinámico.

- 67 -


Fig. 2.2.1 Diagrama de ener gía de dos semiconductores tipo p y tipo n separa dos una distancia d, grande antes de formar la unión.



Fig. 2.2.2 Diagrama que i -lustra la formación de las regiones de carga espacial -C. S. y el campo eléctrico interno É por difusión de portadores mayoritarios cerca de la unión a la región de conductividad opuesta.

• iones de impureze douer + huecos libres • iones de impureze aceptor - dechaus libres



Fig. 2.2.3 Diagrama de ener gía potencial mostrando la configuración de bandas cerca de la unión sin voltaje externo aplicado.

- 68 -

Para obtener el potencial de contacto ϕ_o , se utilizan lasrelaciones de la densidad de electrones en equilibrio en ambos lados de la unión lejos de la región especial de carga⁽¹⁵⁾ (lo mismo se obtiene usando la densidad de huecos), que son, en el lado n

$$N_{m} = V_{c} e^{-(E_{e_{m}} - E_{f})/kT}$$
 (2.2.1)

y la densidad de electrones en el lado p

$$M_{p_0} = V_c e^{-(E_{c_0} - E_f)/k_T}$$
 (2.2.2)

donde la densidad de estados efectivos en la banda de conducción $U_c = 2 \left(2\pi m_u^4 k T/\mu^2 \right)^{3/2}$, con M_u^4 la masa efectiva del electrón k la constante de Boltzmann y T la temperatura absoluta. Lo anterior es en la aproximación de Boltzmann.

La energía potencial $e\phi_{e}$ es la diferencia entre el borde de la banda de conducción $E_{c_{p}}$ en el lado p y la energía del bor de de la banda de conducción $E_{c_{n}}$ en el lado n, según se mue<u>s</u> tra en la figura (2.2.3). De las relaciones (2.2.1) y (2.2.2) r<u>e</u> sueltas para $E_{c_{n}}$ y $E_{c_{p}}$, se expresa como

$$e \phi_{o} = E_{c_{p}} - E_{c_{n}} = KT \ln \frac{M_{m_{o}}}{M_{p_{o}}} \qquad (2.2.3)$$

por lo que

- 69 -

$$\Phi_o = \frac{\kappa \tau}{e} \ln \frac{h_{\tau_o}}{h_{\tau_o}}$$
(2.2.4)

es el potencial de contacto.

Cuando un voltaje externo V_0 es aplicado a la muestra entre los dos componentes de la unión p-n , la caida de voltaje es casi totalmente en la región de la unión donde la resistividad es mayor, ya que en la región espacial de carga hay deficienciade portadores libres; por lo que al aplicar una polarización directa, como se muestra en la figura $(2.2.4_{\rm B})$, el efecto es reducir la barrera de potencial a un valor $\phi_0 - v_0$, donde el voltajeexterno aplicado V_0 se considera positivo. Por lo contrario, si la muestra se polariza inversamente, como se ilustra en la fi gura $(2.2.4_{\rm B})$, se tendro un aumento en el alto de la barrera de potencial ϕ_0 al valor $\phi_0 - v_0$, donde V_0 es considerado in trínsecamente negativo.

En estado de equilibrio termodinámico, existe en el sistema de la unión p-n un flujo de electrones J_{WY} de recombinaciónformado por electrones de la banda de conducción del lado n , donde son portadores mayoritarios, que tienen la energía sufi -ciente para pasar la barrera de potencial y difundirse al lado p , donde se vuelven minoritarios, recombinándose con huecos -después de algún tiempo. Ya que el sistema se halla en equili -brio termodinámico, por el principio del balance detallado de la

mecánica estadística⁽¹⁵⁾, el proceso inverso al flujo de recom-binación Jwy ocurre a la misma velocidad, es decir, se produce un flujo de electrones J_{ng} de generación, del lado p al ladon, formado por electrones, que se vuelven mayoritarios en el la do n, de los pares electrón-hueco generados térmicamente en el lado p y que es igual a $-\int_{hr}$. También se tiene un flujo de -huecos J., de recombinación que está dado por huecos de la banda de valencia la región p que tiene la energía suficiente para pasar la barrera de potencial y difundirse a la región n, donde se vuelven minoritarios recombinándose con electrones . Otravez, por el principio del balance detallado, existirá un flujo -1 de generación compuesto por huecos de la generación térmica de pares en el lado n que se difunden a la región p, volvién dose mayoritarios, y que es igual a - Jer, ya que ningún flujo neto de corriente debe tenerse en condiciones de equilibrio termodinámico. Lo anterior se ilustra en la figura (2.2.5).

Como ya se dijo, cuando un voltaje en polarización directaes aplicado al sistema de la unión p-n, el efecto es reducir el alto de la barrera de potencial al valor $\phi_0 - V_0$ con $V_0 > 0$, por lo que, los electrones del lado n, que son portadores mayo ritarios, pueden ahora pasar fácilmente la barrera de potencialy difundirse al lado p, donde se recombinan, y el flujo $\int M_{V}$



Pig. 2.2.4 Diagrama de energía mostrando el efecto que produce la arlicación de una polarización V_o. En a) polarización dire<u>c</u> ta y en b) polarización inversa.



Fig. 2.2.5 Diagrama de bandas de energía en una homounión p-n en condición de equilibrio termodinámico mostrando la distribu ción de portadores y los flujos de generación y recombinación.

- 72 -

es mayor que en estado de equilibrio. En forma similar, ocurre-con los huecos del lado p que pueden difundirse más fácilmente al lado n y el flujo $\int_{\nabla v}$ es bastante mayor que su valor en estado de equilibrio. Los flujos de generación $\int_{\nabla v} y \int_{\nabla v}$ permanecen constantes, ya que solo dependen de la razón de generación térmica y para ellos no existe la barrera de potencial, es decir son independientes del voltaje aplicado V_0 . Esto se ilustra en la figura (2.2.6 a).

Ahora, cuando la polarización es en sentido inverso, el alto de la barrera de potencial se incrementará a una cantidad -- $\phi_o - V_o$, con $V_o < O$, por lo que para los electrones del lado n y los huecos del lado p, portadores mayoritarios, les será más difícil pasar la barrera de potencial, y los flujos de recom binación $\int_{W_Y} y \int_{\varphi_T}$ disminuyen conforme el voltaje externo se in cremente negativamente, haciéndose muy pequeños; pero los flujos de generación térmico $\int_{W_Y} y \int_{\varphi_Y} g$ permanecen inalterados y la den sidad de corriente a través de la unión se aproxima al valor -constante $-e(\int_{\varphi_Y} + \int_{W_Y})$; la figura (2.2.6 b) muestra esta si tuación.

Se calculará, a continuación, la densidad de corriente ele<u>c</u> trica a través de la unión cuando existe un voltaje externo V_O aplicado.

- 73 -



Fig. 2.2.6 Diagrama de energía potencial de una homounión p-n mostrando la modificación de los flujos de recombinación. En a) polarización directa y b) polarización inversa.



Fig. 2.2.7 Comportamiento de corriente-voltaje de una homounión p-n . Nótese que la corriente en polarización inversa tiende a - I_0 - 74 - El número de electrones que tienen la energía suficiente -para pasar la barrera de potencial $\phi_o - v_o$ es proporcional⁽¹⁵⁾ a $e^{-e(\phi_o - v_o)/_{i \in T}}$ (suponiendo la aproximación Maxwell-Boltz -mann), por lo que, los flujos J_{w_T} y J_{ψ_T} son proporcionales a $e^{-ev_o/_{w_T}}$, esto es,

$$J_{nr} = J_{nr} e^{evo/ict} \qquad (2.2.5)$$

$$J_{pr} = J_{Pr_0} e^{ev_0/kT} \qquad (2.2.6)$$

donde $\int_{W_{V_o}} y \int_{PV_o} son los flujos de recombinación de electrones$ y huecos, respectivamente, en condiciones de equilibrio. Ya que $el flujo de recombinación <math>\int_{W_V} = \int_{W_o} en condiciones de equili$ $brio (V_o = 0), el flujo de generación <math>\int_{W_o} debe ser igual a \int_{W_V_o}$. En forma similar $\int_{PV_o} debe ser igual a \int_{V_o} en condicio$ nes de equilibrio. Las expresiones (2.2.5) y (2.2.6) pueden en tonces expresarse como

$$J_{Hr} = J_{Hg} e^{2Vo/kT} \qquad (2.2.7)$$

$$J p_r = J p_g e^{2Vo/kT} \qquad (2.2.8)$$

У

El flujo neto de electrones y de huecos, tomando en cuentalas relaciones (2.2.7) y (2.2.8) es

$$J_{n} = J_{ng} - J_{nr} = -J_{ng} \left(e^{e^{V_{0/kT}}} - 1 \right)$$
 (2.2.9)

y

$$J_{p} = J_{pr} - J_{pg} = J_{pg} (e^{ev_{/ier}} - 1)$$
. (2.2.10)

La densidad de corriente eléctrica a través de la unión en fun ción del voltaje aplicado V_o será

$$J = e(J_{p} - J_{n}) = J_{0}(e^{ev_{0/nT}} - 1), \quad (2.2.11)$$

donde

$$J_0 = e \left(J_{Pg} + J_{Ng} \right)$$
 (2.2.12)

es la densidad de corriente inversa de saturación, formada por la suma de las densidades de corriente de generación.

La gráfica de la relación (2.2.11) se tiene en la figura -(2.2.7) que muestra el comportamiento como diodo rectificador de la unión p-n. Como se observa en la gráfica de la figura ---(2.2.7), la densidad de corriente eléctrica aumenta exponencialmente para polarización directa y tiende al valor de la corriente de saturación en polarización inversa.

- 76 -

Ahora, se analizará brevemente la heterounión. Una hetero unión es el contacto formado por los materiales semiconductoresdiferentes, que en general, uno es de tipo p y el otro tipo n

Considérese dos semiconductores, uno tipo n y otro tipo p, separados una distancia d grande para que no haya interac ción, como se muestra en la figura (2.2.8) en la que se indicanlos parámetros importantes, donde los índices n y p son para denotar los semiconductores tipo n y tipo p, respectivamen-te; \varkappa es la afinidad electrónica. En la figura (2.2.8) se obser va que la energía de Fermi E_{in} del semiconductor tipo n es ma yor que la correspondiente ε_{ip} del semiconductor tipo p y la brecha energética E_{g_n} mayor que E_{g_ip} .

Al hacer la distancia d más pequeña y tener el contacto formado, electrones del semiconductor tipo n pasarán al semi conductor tipo p hasta igualar los niveles de Fermi y alcanzar se el equilibrio termodinámico, produciéndose una deficiencia de portadores mayoritarios cerca de la unión, que curva los niveles de energía de las bandas de conducción y de valencia⁽¹⁶⁾ como se muestra en la figura (2.2.9).

Las cantidades $V_{D_n} \overset{v}{\leftarrow} V_{D_p}$ son los doblamientos de los nive les en el semiconductor tipo n y tipo p , respectivamente. N<u>ó</u> tese los escalones de energía formados en las bandas de conduc -

- 77 -

ción Δ_{E_c} y de valencia Δ_{E_v} , debidos a las diferencias en las brechas energéticas E_g y funciones de trabajo o afinidades e lectrónicas de los semiconductores que (erman la unión⁽¹⁶⁾. El -diagrama de energía de una heterounión, figura (2.2.9), es más complicado que para una homounión, véase figura (2.2.3), en donde no existen los escalones energéticos $\Delta_{E_c} + \Delta_{E_v}$.

De las figuras (2.2.8) y (2.2.9), se tiene que

$$E_{f_{p}} - E_{f_{n}} = (\chi_{p} + E_{p} - \xi_{p}) - (\chi_{n} + \xi_{n}) = v_{D_{n}} + v_{D_{p}} \qquad (2.2.13)$$

У

$$\Delta \varepsilon_{c} = S_{n} + V_{D_{n}} - (\varepsilon_{q_{p}} - S_{p}) + V_{D_{p}} . . . (2.2.14)$$

Sustituyendo la relación (2.2.13) en (2.2.14), se llega a

$$\Delta \mathbf{E}_{c} = \mathbf{\chi}_{\mathbf{p}} - \mathbf{\chi}_{\mathbf{n}} \qquad (2.2.15)$$

esto es, que el escalón energético en la banda de conducción está dado por la diferencia de las afinidades electrónicas de lossemiconductores.

También se obtiene, de consideraciones energéticas de la f<u>i</u> gura (2.2.9), que el escalón energético ΔE_V en la banda de valencia se expresa como

$$\Delta E_{V} = (Eq_{n} - Eq_{p}) - (\chi_{p} - \chi_{u}).$$
 (2.2.16)

- 78 -



Fig. 2.2.8 Diagrama de ban das de dos semiconductoresdiferentes separados una -distancia d grande antes de formar la unión, en la quese indican los parámetros importantes, donde $E_{g_n} > E_{g_n}$ y $E_{g_n} > E_{g_n}$.

tipe m

tipe P



Fig. 2.2.9 Diagrama de e nergía potencial de la es tructura de bandas de una heterounión formada con los semiconductores de la fig.-2.2.8, donde as observan los escalones de energía At. y At.



tipep



Fig. 2.2.10 Diagrama de bandas de energía de una he terounión $E_{0} > E_{1}$.

1

1

De las relaciones (2.2.15) y (2.2.16), se tiene

$$\Delta \varepsilon_c + \Delta \varepsilon_v = \varepsilon_{g_N} - \varepsilon_{g_P} . \qquad (2.2.17)$$

En el modelo simple de la figura (2.2.9) no se ha consider<u>a</u> do estados energéticos de interfase, que son importantes en la práctica, sobre todo cuando las constantes de red difieren más del 1 % o tienen grandes diferencias en sus coeficientes de ex pansióntérmica los componentes de la unión⁽¹⁶⁾. Resultados similares del diagrama de energía se obtienen en una heterounión p-n donde la brecha energética $E_{g,p}$ es mayor que $E_{g,n}$, como se i lustra en la figura (2.2.10).

En el caso presentado en la figura (2.2.9) la barrera en la - banda de conducción es menor que la barrera en la banda de valen cia, por lo que se podría despreciar el flujo de huecos al aplicar una polarización y sólo considerar el flujo de electrones pa ra obtener la densidad de corriente.

Al aplicar un voltaje externo en polarización directa, el alto de la barrera disminuye tanto en la banda de conducción como de valencia, aumentando en consecuencia el flujo de corriente; por el contrario, al polarizar inversamente, el alto de las ba rreras aumenta y la corriente tiende hasta un cierto valor de sa turación. Por lo tanto, la unión se comporta como diodo rectificador.

La relación corriente-voltaje para una heterounión como lamostrada en la figura (2.2.9) es⁽¹⁶⁾

$$J = J_{0} [e^{4V/kT} - i] + J_{V_{0}} [e^{4V/2kT} - 1] , \qquad (2.2.18)$$

donde $\int_{a_0} y \int_{r_0} son las componentes de la densidad de corriente$ de saturación inversa debidas a difusión y recombinación-generación, respectivamente, en la región de deficiencia.

Unión metal-metal y unión metal-semiconductor de barrera --Schottky.

Considérese dos metales M_{1} y M_{2} con funciones de trabajodiferentes $e \phi_{1} + e \phi_{2}$ separados una distancia d, como se mues tra en la figura (2.2.11) en un diagrama de energía⁽¹⁵⁾. En este caso el metal M_{1} , tiene función de trabajo menor (nivel de Fer mi mayor) que el metal M_{2} . Inicialmente los dos metales estánseparados una distancia d grande, como en la figura (2.2.11 a) Conforme la distancia de separación d es disminuida para for mar el contacto, la probabilidad de tunelaje aumenta y hay un -flujo de electrones del metal M_{1} al metal M_{2} , con menor energía de Fermi, hasta alcanzarse el equilibrio termodinámico cuando los niveles de Fermi se igualan. En el metal M_{1} queda un exceso de carga positiva y en el metal M_{2} un exceso de carga nega tiva, que genera una diferencia de potencial, llamado potencialde contacto de magnitud $\phi_z - \phi_i$. En estado de equilibrio el flujo de corriente neto es cero y el potencial de contacto se en cuentra en la interfase, ya que en un metal no puede existir uncampo eléctrico en su interior, como se muestra en la figura --(2.2.11 c).

En una unión metal-semiconductor puede formerse una barrera de potencial o una región de acumulación de carga dentro del semiconductor, según las características de los componentes que -forman la unión. Esta es la diferencia fundamental con respectoa la unión metal_metal.

Se considerará ahora la formación de una unión metal-semi conductor siguiendo el modelo de Schottky. En los contactos me tal-semiconductor pueden darse cuatro casos, según las caracte-rísticas de los componentes que forman la unión. Si el contactoes metal-semiconductor tipo n , se tienen dos casos: cuando lafunción de trabajo del metal $c\phi_{\mu}$ es menor que la función de -trabajo del semiconductor $e\phi_{\mu}$ y cuando se tiene $e\phi_{\mu} > e\phi_{\mu}$. Se tienen dos casos similares cuando el semiconductor que forma launión es tipo p.

En caso de una unión metal-semiconductor tipo n y ed - s se ilustra en la figura (2.2.12) donde se observa el proceso de-

- 82 -



ig. 2.2.11 Diagrama de energías en las etapas de la formación de unión metal-metal, hasta alcanzar el equilibrio termodinámico c) y generarse un diferencia de potencial de contacto $\phi_s - \phi_t$.

5)

c)

a)



z. 2.2.12 Diagrama de energía en las etapas de la formación de a unión metal-semiconductor tipo n hasta alcanzar el equili -no termodinámico, con $\phi_n > \phi_n$, donde se genera una barrera de tencial de contacto $\phi_n - \phi_n$.

- 83 -

formación de contacto. En la figura (2.2.12 a) se muestra el metal con función de trabajo e_{Φ_n} y el semiconductor tipo n con función de trabajo e o separados una distancia grande d; como se observa, el nivel de Fermi E, del semiconductors es mayor que en el metal E_{f.}. Al acercar los componentes para formar el contacto, un flujo de electrones de la banda de conducción del semiconductor se establecerá hacia el metal, que tiene energía de Fermi menor, hasta alcanzar el equilibrio termodinámico, gene rando una región de deficiencia de portadores mayoritarios cerca na a la superficie del semiconductor que crea un potencial de -contacto, pero que se encuentra bastante dentro del semiconduc tor, por lo que las bandas de energía de éste se curvan como semuestra en la figura (2.2.12 c). El alto de la barrera de potencial formada en el contacto es $\phi_{-}\phi_{-}$, por lo que la energía de un electrón en reposo, en el fondo de la banda de conduccióndel semiconductor en el volumen (lejos del contacto) es menor que la que tendría en la superficie por una cantidad $e(\phi_{H}-\phi_{L})$, como se muestra en la figura (2.2.12 c). Si $\phi_{\mu}-\phi_{\mu}$ es muy grande, la banda de valencia cerca de la superficie del semiconduc-tor estará más próxima al nivel de Fermi que la banda de conducción, por lo que el semiconductor cambiará a tipo p. En este caso, se forma una capa adyacente a la interface llamada " re -

- 84 -

gión de inversión", como se ilustra en la figura (2.2.16).

La formación de la región de deficiencia y la barrera de p<u>o</u> tencial son la base del funcionamiento como diodo rectificador de la unión metal-semiconductor, que se analizará después.

Ahora se considerará el caso de la unión metal-semiconduc tor tipo n, pero con la función de trabajo del metal menor quela del semiconductor, esto es 20, ceo, El proceso de formacióndel contacto se ilustra en la figura (2.2.13). En la figura (2.2.13 a) se encuentran el metal y el semiconductor separados u na distancia d grande y están señalados los parámetros impor tantes de los dos materiales. Cuando el metal y el semiconductor están lo suficientemente cercanos, se produce un flujo de elec trones desde el metal, con energía de Fermi mayor que el semicon ductor, hasta que se igualan los niveles de Fermi. Una vez que se llega al estado de equilibrio termodinámico, en la región del semiconductor adyacente a la superficie se forma una región de a cumulación de carga, que mantiene una diferencia de potencial de contacto entre el metal y el semiconductor. Aquí, a diferencia con respecto al caso de s de , no se forma una barrera de potencial para los portadores mayoritarios del semiconductor, sino una región de acumulación de carga negativa; como se observa en la figura (2.2.13 c) las bandas de conducción y de valencia delsemiconductor se curvan hacia abajo.

- 85 -

Se analizarán ahora los contactos de metal-semiconductor -tipo p en los casos cuando la función de trabajo del metal $e\phi_m$ es mayor que la función de trabajo del semiconductor $e\phi_s$, y viceversa.

En la figura (2.2.14) se ilustra el proceso de formación -del contacto metal-semiconductor tipo p con $\phi_{M} > \phi_{S}$. Los -dos materiales estando separados una distancia grande según se muestra en la figura (2.2.14 a), donde se observa que la función de trabajo del metal ϕ_{N} es mayor que la del semiconductor ϕ_{S} , cuando se acercan para ponerse en contacto, se produce un flujode electrones de la banda de valencia del semiconductor, con e nergía de Fermi mayor, al metal cuya energía de Fermi es menor --véase figura (2.2.14 b)- hasta que se alcanza el euilibrio termodinámico. La región de contacto en el semiconductor, se enrriquece de huecos, que son mayoritarios, por los electrones que pa san al metal formándose así una región de acumulación de portado res positivos. Esto genera una diferencia de potencial de contac to igual a $\phi_{n} - \phi_{n}$, como se muestra en la figura (2.2.14 c).

Ahora, en el contacto metal-semiconductor tipo p con función de trabajo del metal $e \phi_m$ menor que la función de trabajo del semiconductor $e \phi_s$, que está ilustrado en la figura (2.2.15), -cuando los dos materiales se acercan para formar el contacto, e-



Fig. 2.2.13 Etapas succesivas en el establecimiento del equilibrio termodinámico en la formación de la unión metal-semiconductor tipo n , con $\phi_n < \phi_n$, en la que se forma una región de acumulación y - un potencial de contacto $\dot{\phi}_n - \dot{\phi}_n$.



Fig. 2.2.14 Diagramas de la estructura de bandas que muestran laformación de la unión metal-semiconductor tipo p con $\phi_m > \phi_n > \phi_n$, -donde se genera un potencial de contacto $\phi_m - \phi_n$ y la región de acumulación. lectrones del metal pasan a ocupar algunos estados vacíos en labanda de valencia del semiconductor, produciendo una región de deficiencia de portadores mayoritarios en este último próxima al contacto. Esto genera una diferencia de potencial que curva lasbandas de conducción y de valencia del semiconductor hacia abajo formando una barrera de potencial de valor $\phi_{\rm M}$ - $\phi_{\rm e}$ para los -portadores mayoritarios, huecos, del semiconductor -ver figura -(2.2.15 c). Si $\phi_{\rm M}$ - $\phi_{\rm s}$ es muy grande, además de deficiencia de por tadores mayoritarios se puede formar una región de inversión, co mo se observa en la figura (2.2.17).

Se obtendrá a continuación, en base al modelo de Schottky,la característica corriente-voltaje I-V de la unión metal-semi conductor tipo p con $\phi_n < \phi_s$, que es la unión que se utiliza para la elaboración de celdas fotovoltaicas en este trabajo. Eltratamiento es muy similar al seguido en la homounión p-n al principio de esta sección.

Considérese la unión metal-semiconductor tipo p de la figura (2.2.18), donde la función de trabajo del metal e_{ϕ_n} es me nor que la función de trabajo del semiconductor e_{ϕ_n} , en equilibrio termodinámico. El alto de la barrera que se forma para losportadores mayoritarios (huecos) en energía, es

$$e\phi_{s} = e(\phi_{H} - \phi_{s}) . \qquad (2.2.19)$$

- 88 -



Fig. 2.2.15 Diagrama de bandas de energía que muestra las etapas en la formación de la unión metal-semiconductor tipo p con $\phi_m < \phi_n$, - donde se forma una región de deficiencia y una barrera de potencial- $\phi_m - \phi_h$.



Fig. 2.2.16 Formación de una región de inversión en la interfase de una unión metal-semiconduc tor tipo n cuando $\phi_{N}-\phi_{0}$ ce muy grande $(\phi_{N} > \phi_{0})$.

Fig. 2.2.17 Formación de una región de inversión en la unión metal-semiconductor tipo p cuando $\phi_s - \phi_m$ es muy grande $(\phi_m < \phi_s)$, En estado de equilibrio, existirá un flujo de huecos J_p - del se miconductor al ametal, que tienen la energía suficiente para pasar la barrera de potencial ϕ_b y, por el principio de balancedetallado de la mecánica estadística, habrá un flujo de huecos - J_{ϕ}^+ generados en la superficie del semiconductor que se difunden dentro del volumen de éste, igual en magnitud que J_{ϕ}^- para que la corriente neta de huecos sea cero. También existirá un flujode electrones J_{ϕ}^+ del metal al semiconductor, que tienen la ener gía necesaria para pasar la barrera de potencial ϕ_b y, nueva mente por el principio de balance detallado, habrá un flujo de <u>e</u> lectrones J_{ϕ}^- de la banda de conducción del semiconductor al <u>me</u> tal igual en magnitud a J_{ϕ}^+ .

Ahora, si un voltaje externo V_0 es aplicado al contacto en polarización directa (el semiconductor positivo respecto al metal), como se muestra en la figura (2.2.19), el efecto es disminuir el alto de la barrera de energía, para los portadores mayori tarios, a un valor $e(\phi_0 - v_0)$ con $v_0 > 0$, por lo que será másfácil para los huecos del semiconductor pasar al metal, aumentan do de esta manera el flujo J_0^- , y a los electrones del metal -les sucederá lo mismo, por lo que se incrementará el flujo J_0^+ . Los flujos J_0^+ y J_0^- permanecem iguales, ya que éstos sólo de penden de la generación térmica de portadores producidos en el -



Fig. 2.2.18 Diagrama de bandas de energía de una unión metal--semiconductor tipo p en condi ciones de equilibrio termodiná-mico, donde se muestran los flu jos J_n y J_p .



Fig. 2.2.19 Diagrama de bandas de energía mostrando el cambiode la barrera e_{b} y de los flu jos J_n y J_p cuando se aplica una polarización directa, $V_0 > 0$.



Fig. 2.2.20 Diagrama de ener gía donde se muestra el cambioen la barrera $e \phi_0$ y los flujos J_n y J_p cuando se aplica una po larización inversa, $V_0 \leqslant 0$.

- 91 -

interior de los materiales que componen la unión y de sus paráme tros, por lo que son independientes del alto de la barrera --- $e(\phi_{0}-V_{0})$. Los flujos \int_{ϕ}^{-} y \int_{h}^{+} dependen del número de portado res presentes en el semiconductor y el metal que tienen la energía suficiente para pasar la barrera $e(\phi_{0}-V_{0})$, que son proporcionales⁽¹⁵⁾ a $e^{-e(\phi_{0}-V_{0})/_{h}\tau}$ y por lo tanto se pueden expresar como

$$J_{p} = -J_{r_{0}} e^{-e(\phi_{b}-v_{0})/(cT)}$$
 (2.2.20)

 $J_{n} = J_{n} e^{-e(b_{b}-v_{o})/icT}$, (2.2.21)

donde j_{P_0} y j_{N_0} son los flujos de huecos y electrones de cual-quier energía que inciden sobre sobre la barrera en condicionesde equilibrio. Como j_P^+ y j_N^- son independientes del voltaje a plicado y deben ser iguales a $-j_P^-$ y $-j_N^+$ en condiciones de e quilibrio ($V_0 = 0$), dichos flujos se pueden escribir como

$$J_{p}^{+} = J_{p_{0}} e^{-e \phi_{b}/kT}$$
 (2.2.22)
 $J_{n}^{-} = -J_{n_{0}} e^{-e \phi_{b}/kT}$ (2.2.23)

У

У

У

Los flujos totales de huecos y electrones son iguales a

$$J_{\mathbf{p}} = J_{\mathbf{p}}^{\dagger} + J_{\mathbf{p}}^{\dagger} \qquad (2.2.24)$$

$$J_{n} = J_{n}^{+} + J_{n}^{-}$$
, (2.2.25)

- 92 -

los que, tomando en cuenta las relaciones de (2.2.20) a (2.2.23) se pueden expresar como

$$J_{p} = -J_{p} e^{-e\Phi_{b}/kT} \left[e^{eV_{o}/kT} - 1 \right] \qquad (2.2.26)$$

 $J_n = J_n e^{-e \phi_{kT}} [e^{e \psi_{kT}} - 1]$ (2.2.27)

La densidad de corriente total es

$$J = e(J_{n} - J_{p}),$$
 (2.2.28)

que utilizando las expresiones (2.2.26) y (2.2.27) se expresa co mo

$$J = J_{o}(e^{e^{V_{o}/kT}} - 1)$$
 (2.2.29)

$$J_{o} = e(J_{w_{o}} + J_{P_{o}}) e^{-eP_{b}/_{KT}}$$
 (2.2.30)

donde

У

Si la polarización aplicada a la unión es inversa, es decir el semiconductor negativo respecto al metal, el efecto es aumentar el alto de la barrera al valor $e(\phi_{\bullet} - V_{\bullet})$ con $V_{\bullet} < 0$, porlo que los flujos J_{\bullet} y J_{\bullet}^{+} se reducen, ya que como se dijo sonproporcionales a $e^{-e(\phi_{\bullet} - V_{\bullet})/kT}$, mientras que los flujos J_{\bullet}^{+} y J_{\bullet}^{-} permanecen constantes. La densidad de corriente sigue estando da da por la relación (2.2.29) con $V_{\bullet} < 0$. Esto se ilustra en la figura (2.2.20).

La gráfica de la densidad de corriente respecto al voltaje-

- 93 -

aplicado dada por (2.2.29) se tiene en la figura (2.2.21), donde se observa que en polarización directa la densidad de corrienteaumenta exponencialmente y en polarización inversa dicha densi dad de corriente tiende a - J_o . Por lo que el comportamiento de la unión en su característica corriente-voltaje es la de un diodo rectificador, como sucede en la homounión p-n, pero con dia tinta⁽¹⁵⁾ corriente de saturación J_o . En el caso de la unión metal-semiconductor presente J_o depende únicamente de la genera ción térmica de portadores, ya que los flujos J_o^- y J_o^+ tiendena cero cuando el voltaje de polarización inversa se incrementa.-El mismo comportamiento de diodo rectificador se obtiene en la <u>u</u> nión metal-semiconductor tipo n cuando la función de trabajo del metal $e \phi_n$ es mayor que la función de trabajo del semiconductor $e \phi_5$.

Los casos de unión metal-semiconductor tipo n con función de trabajo del metal $e\phi_{\mu}$ menor que la del semiconductor $e\phi_{\mu}$ y la unión metal semiconductor tipo p con función de trabajo $e\phi_{\mu}$ ma yor que $e\phi_{\mu}$ donde se forman regiones de acumulación, según se <u>i</u> lustra en las figuras (2.2.13) y (2.2.14) o cuando $\phi_{\mu} = \phi_{\mu}$, se comportan como contactos óhmicos, ya que no hay una barrera de potencial⁽¹⁵⁾ para los portadores mayoritarios del semiconduc -tor.

- 94 -

El alto de la barrera $a \phi_b$ puede ser determinada a partir¹⁶ de la gráfica de la energía de activación para la unión metal -semiconductor para un voltaje de polarización directa fijo, también puede ser determinado de las medidas de la respuesta espectral de fotoexitación de la unión y a partir de la densidad de corriente en función del voltaje a polarización directa de la unión metal-semiconductor. Esta última forma es la que se utiliza para la determinación experimental en este trabajo.

La densidad de corriente, según el modelo de Schottky, está dada por la relación (2.2.29), que se puede escribir como

$$J = J_{o} \left(e^{e V_{o} A K T} - 1 \right)$$
 (2.2.31)

$$J_0 = C e^{-e\Phi_0/AKT}$$
 (2.2.32)

con

$$c = e(J_{N_0} + J_{P_0}),$$
 (2.2.33)

donde se ha agregado el factor A, que es el factor de calidadde la unión⁽¹⁷⁾. De la expresión (2.2.31) se obtiene

$$\ln J = \ln J_0 + \ln (e^{e^{2} \frac{\pi}{4} \frac{\pi}{1}})$$
 (2.2.34)

tomando el factor de calidad igual a la unidad -caso ideal⁽¹⁷⁾-cuya gráfica se muestra en la figura (2.2.22) en polarización -directa. Como se observa, cuando $e_{V_0} \gg k_T$ la curva tiende a ser <u>u</u> na recta con pendiente <u>e</u> que al extrapolarla hasta el eje de -

- 95 -



Fig. 2.2.21 Comportamiento de la densidad de cerriente con respecto al voltaje de polarisación dado por la relación -(2.2.29)



Fig. 2.2.22 Gráfica de $\ln 3$ Vs. V. en polarización directa-(linea punteada). Nótese que para eV₀ >> KT la curva tiendea una recta (linea sólida), cuya extrapolación a voltaje ce ro sirve para determinar la densidad de corriente de satura ción inversa J₀. las ordenadas, su ordenada al origen es $\ln J_0$. De esta forma y apartir de la relación (2.2.32) se puede obtener el alto de la b<u>a</u> rrera ed_b, que se expresa como

$$|e\phi_b| = AKT | lnc - ln J_{\bullet}|$$
 (2.2.35)

cuyo valor indica qué tan buena es la unión rectificadora, ya -que de la relación (2.2.32) se tiene que si $e \phi_b$ es pequeña la corriente de saturación es grande, y viceversa. El parámetro c de la relación (2.2.32) es constante o dependiente de la tempera tura⁽¹⁶⁾ según el modelo utilizado para el flujo de portadores:emisión o difusión.

2.3 Efecto fotovoltaico y características de celdas solares. En la sección anterior se analizaron uniones con diferentes componentes, la homounión p-n, la heterounión y la unión metal semiconductor de barrera Schottky, y se vió que algunas funcio nan como contactos óhmicos y otras como contactos rectificadores en su característica corriente-voltaje. En esta sección se verála aplicación de la unión rectificadora en celdas solares y losparámetros que la caracterizan.

Considérese un semiconductor con brecha energética E_g enel que incide luz monocromática de energía hv; según se expli-

- 97 -

có en la sección 1.3, la intensidad de la luz que penetra en el materia disminuye exponencialmente debido a la absorción. Sila energía de los fotones incidentes es mayor que la brecha ener gética, dicha energía se absorverá generando pares electrón -hueco en el semiconductor, y cuando la energía de los fotones es menor que la brecha energética, se disipa en forma de calor (fonones). La generación de pares electrón-hueco por la luz inciden te es uno del fenómenos básicos en la producción del efecto foto voltaico.

Considérese ahora una unión rectificadora, es decir, dondeexiste una barrera de potencial $\epsilon \phi_b$ para los portadores mayoritarios, por ejemplo, una homounión p-n. Cuando sobre ella incideun haz de luz monocromática ionizante $(hv > E_g)$, se generanpares electrón-hueco, donde los electrones generados en exceso en la región p se difunden a la unión y descienden la barrerade potencial a la región n, en tanto que los huecos generadosen exceso en la región n, se difunden a través de la unión a la región p⁽¹⁵⁾, por lo que se produce una disminución en el al to de la barrera al valor $\epsilon(\phi_b - v_f)$, véase figura (2.3.1), don de V_f es la diferencia de potencial que aparece en las terminales del dispositivo, como se muestra en la figura (2.3.2). A este fenómeno se le llama efecto fotovoltaico y el voltaje de sali



Fig. 2.3.1 Diagrama de ener gía de una homounión p-n en la oscuridad y con luz ionizante, en la que se observa el cambio en la barrera de potencial.

Fig. 2.3.2 Una diferencia depotencial V_f aparece entre las terminales de la homounión p-n cuando incide sobre ella luz ionizante. A este efecto se le llama fotovoltaico.



Fig. 2.3.3 Unión metal-semicon ductor tipo p rectificador enla que se produce el efecto fo tovoltaico. Se observa en el diagrama la resistencia de car ga R_L , la corriente de salida I_B y el voltaje de salida V_B .

- 99 -

da es conocido como fotovoltaje⁽¹⁵⁾. Cuando el circuito externose cierra, fluirá una corriente eléctrica mientras haya una corriente de difusión a la región n de electrones generados ópti camente en el lado p y una corriente de huecos a la región pgenerados ópticamente en la región n, que mantenga el alto dela barrera a un valor diferente de $e \phi_b$. En condiciones de circuito cerrado, las corrientes de generación son más grandes quelas corrientes de recombinación y precisamente dichas corrientes de generación son la fuente de la corriente que fluye en el circuito externo.

Para que se produzca el efecto fotovoltaico, es necesario que se generen pares electrones-hueco como portadores libres enexceso, creados por la absorción de la luz ionizante, y una ba rrera de potencial ..., que los separe, esto es, un contacto re<u>c</u> tificador. Por lo antericr, el efecto fotovoltaico también se -produce tanto en una heterounión como en un contacto metal-semiconductor con tal de que sean rectificadores. En otras palabras, el efecto fotovoltaico, en general, es la generación de una fue<u>r</u> za electromotriz como resultado de la absorción de luz ionizante que incide sobre dos sustancias.⁽¹⁸⁾

Se considerará ahora el efecto fotovoltaico con más deta lle en un contacto rectificador metal-semiconductor tipo p debarrera Schottky, que es utilizado en este trabajo.

La unión metal-semiconductor tipo p con función de trabajo del metal e_{Q_n} menor que la función de trabajo del semiconductor e_{Q_n} , como se analizó ya, es un contacto rectificador cuya característica corriente-voltaje está dada según el modelo de --Schottky, por la relación (2.2.31), con factor de calidad A, es to es,

$$J = J_0 \left(e^{e_{V_0/AKT}} - 4 \right),$$
 (2.3.1)

cuya gráfica se ilustra en la figura (2.2.21). Si la unión se em plea como una celda solar (fotovoltaica), según se ilustra en la figura (2.3.3), al ser iluminada con luz de energía W mayor que la brecha energética del semiconductor E_g , se generan en éste pares electrón-hueco en exceso libres de moverse, que se di funden a la región de la unión donde son separados por la barrera $e\phi_b$, por lo que en el metal que dará un exceso de carga nega tiva y en el semiconductor un exceso de carga positiva que dismi nuye el alto de la barrera a un valor $e(\phi_b-V_{ij})$ como se ilustra en las figuras (2.3.4) y (2.3.5), produciéndose el efecto foto-voltaico y circulará por el circuito externo una corriente eléctrica, ver figura (2.3.3). El comportamiento de la corriente desalida T_s y el voltaje de salida V_s de la fotocelda bajo ilumi nación se analizará después de señalar su comportamiento en la -



Fig. 2.3.4 Generación de pares electrón-hueco por la luzionizante que incide en la unión metal-semiconductor tipop que son separados por la ba rrera de potencial et.



Fig. 2.3.5 La separación de pares electrón-hueco fotogenerados hace que baje la barrera de potencial al valor $\phi_b - V_i$ produciéndose el efecto foto voltaico. El valor del fotovo<u>l</u> taje es V_i.



Fig. 2.3.6 Circuito equivalen te de una fotocelda en el quese observa que la fotocorriente I_{p_h} es opuesta en dirección a la del diodo rectificador en la oscuridad I_d .

- 102 -

oscuridad.

La característica corriente-voltaje de la celda fotovoltaica en la oscuridad cuando externamente se polariza directa e inversamente, es la de diodo rectificador, como se muestra en la-figura (2.2.21), ya que la fotocelda no es mas que una unión metal-semiconductor con contactos terminales óhmicos en los extremos del metal y el semiconductor para colectar los portadores <u>ge</u> nerados por la absorción de luz ionizante, por lo que la relación voltaje-corriente sigue dada por la (2.3.1), donde \bot es la de<u>n</u> sidad de corriente en la oscuridad, que se denotará por J_{Δ} , esto es

$$J_{4} = J_{\bullet} \left(e^{e^{V_{\bullet}/A \times T}} - 1 \right)$$
 (2.3.2)

Como todo generador de potencia eléctrica, una fotocelda -tiene una resistencia interna. Esta se compone de dos partes⁽¹⁷⁾ una resistencia en serie R_s y otra resistencia en paralelo $R_{Bh,-}$ La resistencia en serie se debe a los contactos óhmicos utilizados en la fotocelda y a la resistencia intrínseca de sus compo nentes, metal y semiconductor. La resistencia en paralelo R_{Sh} -puede ser causada por fugas superficiales a lo largo de los bordes de la celda, por difusión a lo largo de dislocaciones o fro<u>n</u> teras de grano, puentes metálicos a través de microcircuitos, -fronteras o defectos cristalinos tales como fallas después de ha cer el contacto óhmico.

- 103 -
El circuito equivalente más simple de una fotocelda⁽¹⁷⁾ esel mostrado en la figura (2.3.6), donde la fotocorriente está r<u>e</u> presentada por un generador de corriente \mathbf{T}_{ph} que es opuesta a la corriente dada por el diodo rectificador en la pscuridad, \mathbf{T}_{a} en polarización directa; \mathbf{R}_{ah} es la resistencia en paralelo y \mathbf{R}_{a} la resistencia en serie que se mencionaron antes; \mathbf{T}_{a} y \mathbf{V}_{a} son la corriente y voltaje de salida, respectivamente, y \mathbf{R}_{a} es unaresistencia de carga.

Aplicando las leyes de Kirchoff al circuito de la figura -(2.3.6) se puede obtener una relación entre la corriente y el --voltaje de salida, esto es

$$I_{s} = -I_{pl_{s}} + \frac{V_{s} - I_{s}R_{s}}{R_{s}h} + I_{d}$$
 (2.3.3)

Suponiendo que los efectos de la resistencia en serie y paralelo son despreciables, es decir, $R_{\bullet} \circ y R_{sh} \sim o$, y la corriente enla oscuridad, a partir de la relación (2.3.2), puede expresarsecomo

$$I_{J} = I_{o} \left(e^{2V_{a}/AKT} - 1 \right),$$
 (2.3.4)

ya que la corriente I es la densidad de corriente J multipl<u>i</u> cada por el **áre**a total de la fotocelda, la corriente de salida queda como

Is= - Iph + I. [e"" -1]

(2.3.5)

- 104 -

$$V_0 = V_{s-1} = I_s I_s \times V_s$$
 (2.3.6)

y la corriente a corto circuito T_{sc} , cuando $v_{s=0}$, está dada - por

$$I_{0c} = -I_{ph}$$
 (2.3.7)

Ahora, el voltaje a circuito abierto V_{oc} , es decir, cuando la corriente de salida Is es cero, viene dado por la expresión

$$V_{oe} = \frac{AkT}{e} \ln \left(\frac{I_{sc}}{I_o} + 1 \right) . \qquad (2.3.8)$$

La gráfica de la relación (2.3.5) se muestra en la figura -(2.3.7), donde se señalan los parámetros importantes de una fot<u>o</u> celda: la corriente a corto circuito T_{sc} , el voltaje a circuito abierto V_{oc} , la corriente T_{up} y el voltaje V_{up} a máxima potencia de salida y la resistencia de carga R_{L} para dicha potencia.

La máxima potencia de salida R. está dada por

$$P_{m} = I_{m_{\theta}} \vee V_{m_{\theta}}$$

El voltaje a circuito abierto Voc y la corriente a corto circuito T_{sc} son los valores máximos que puede entregar la fotocelda. El valor R_{L} a máxima potencia se puede obtener geométricamente ing cribiendo el rectángulo de mayor área en la gráfica T_{s} Vs. V_{s} y tomando el inverso de la pendiente de la diagonal, como se muestra en la figura (2.3.7).

La eficiencia de conversión de una fotocelda 🔨 se define-

donde

como

$$\mathcal{N} = \frac{\mathrm{Im} \, \rho \, \mathrm{Vm} \, \rho}{\mathrm{P}_{\mathrm{i}}} \tag{2.3.10}$$

donde P; es la potencia de la luz incidente en la fotocelda. Un parámetro que caracteriza a una fotocelda es el factor de llenado F. F., que se define como

$$F.F. = \frac{ImpVmp}{IscVoc} \qquad (2.3.11)$$

ya que mientras mayor se éste, la eficiencia de conversión tam-bién es mayor. La eficiencia de la fotocelda expresada medianteel factor de llenado es

$$\eta = F.F. \frac{I_{\bullet e} V_{\bullet e}}{P_{i}} , \qquad (2.3.12)$$

donde se observa que, para una potencia incidente constante, laeficiencia es directamente proporcional al factor de llenado.

Por otro lado, si los efectos de las resistencias en seriey en paralelo no se pueden despreciar, la expresión para la corriente de salida I. es más complicada, esto es,

$$I_{s} = -I_{ph} + \frac{V_{s} - I_{s}R_{s}}{R_{sh}} + I_{s} \left[e^{\frac{e(V_{s} - I_{s}R_{s})}{A_{krr}}} - 1 \right]$$
 (2.3.13)

que no es fácilmente manipulable, pero puede observarse que la corriente de salida es menor que la dada por la expresión ----(2.3.5) y trae como consecuencia que la eficiencia de conversión de la fotocelda sea menor.

El efecto de las resistencias en serie \mathcal{R}_{\bullet} y en paralelo - \mathcal{R}_{\bullet} puede observarse⁽¹⁷⁾ si se conecta una resistencia varia ble en serie y en paralelo con la fotocelda, respectivamente. -Cuando la resistencia variable está en serie con la fotocelda,el efecto es disminuir la corriente a corto circuito $\mathbf{L}_{\bullet c}$, de jando constante el voltaje a circuito abierto $V_{\bullet c}$, como se mue<u>s</u> tra en la figura (2.3.8), por lo que la eficiencia de conver -sión se verá disminuida. Si la resistencia variable se conectaen paralelo con la fotocelda bajo iluminación, el comportamiento es el mostrado en la figura (2.3.9), donde se observa que la corriente a corto circuito no cambia, mientras que el voltaje a circuito abierto $V_{\bullet c}$ disminuye conforme la resistencia en parale lo es menor. Otra vez, la eficiencia de conversión de la foto -celda disminuirá.

El problema a resolver, en lo que respecta al efecto de las resistencias en serie y paralelo, para obtener una eficiencia de conversión alta, es minimizar las causas que producen resisten cia en serie alta y resistencia en paralelo baja, como se anotóanteriormente.

Existen varios factores que limitan la eficiencia de conve<u>r</u> sión de una celda fotovoltaica, como son los siguientes: a) Cuando los efectos de las resistencias en serie **R**₃ y en para-



Fig. 2.3.7 Gráfica de la rela ción (2.3.4), donde se señalan los parámetros importantes dela fotocelda bajo iluminación.



Fig. 2.3.8 Efecto de la resig tencia en serie R_B en la relación I_B Vs. V_B, donde se tiene R, $\langle R_{1} \langle R_{2} \rangle \langle R_{3} \langle R_{4} \rangle \langle R_{5} \rangle$. Nótese que V_e se mantiene constante.



Fig. 2.3.9 Effects de la resig tencia en paralelo R_{sh} en la relación I₈ Ve. V₈, donde setione R. > $R_s > R_s > R_d > R_8$. Nótese que la corriente a corto circuito I₈₀ no se ve mod<u>i</u> ficada.

lelo R_{sh} no se pueden despreciar, la corriente de salida T_s dis minuye, lo mismo sucede con el voltaje de salida, y la potenciaque da la fotocelda decrece, dando por resultado una eficienciabaja.

b) Si el espectro solar no se acopla bien al espectro de absor ción del semiconductor utilizado, habrá energía de los fotones incidentes que no es aprovechado en la generación de pares electrón-hueco y se dispersará en forma de calor. Esto baja la efi ciencia de conversión de la celda solar.

c) La profundidad de la unión bajo la superficie iluminada es un factor importante, ya que si la luz se absorbe lejos de la unión las corrientes de difusión tienen que recorrer distancias gran - des hasta alcanzar la unión y parte de ésta se pierde por recombinación en el material, por lo que la profundidad ideal de la unión es del orden de la distancia de decaimiento exponencial $\frac{1}{4}$ asociado con la absorción de la luz incidente⁽¹⁵⁾.

d) El factor de calidad de la unión A, debe ser del orden de launidad para obtener buena eficiencia, ya que en dicho factor sereflejan las imperfecciones del contacto rectificador.

e) Las pérdidas por reflexión alta en la superficie bajo ilumina ción baja la eficiencia de conversión de la fotocelda y es recomendable para minimizar estas pérdidas recubrir la fotocelda con

- 109 -

una capa antireflectante.

2.4 Elaboración de las celdas fotovoltaicas.

El segundo objetivo de este trabajo es la elaboración deceldas fotovoltaicas de semiconductor-metal de barrera Schottkycon subestrato semiconductor Cu_2O y varios metales con diferen tes funciones de trabajo, para observar la participación de és-tos en el alto de la barrera $e^{\frac{1}{2}}$, generada en la unión, en las las características rectificadoras y en la eficiencia de conversión.

Las celdas producidas son las llamadas de pared anterior, que se iluminan por el lado del metal, por lo que la capa metál<u>i</u> ca debe ser transparente a la luz solar para permitir su penetr<u>a</u> ción hasta el semiconductor donde se generarán los pares de carga libre electrón-hueco. Los metales utilizados son Cu, In, Al y Cr, que tienen función de trabajo menor que el semiconductor --Cu₂O y teóricamente forman unión rectificadora. En la tabla ----(2.4.1) se dan las funciones de trabajo de los componentes de la unión incluyendo la de Au que es mayor que la del semiconductor-Cu₂O y forma contacto óhmico con éste.

La figura (2.4.1) muestra el esquema de las celdas fotovoltaicas elaboradas; en la figura (2.4.1 a) se observa un corte ---



Fig. 2.4.1 Esquema de las celdas fotovoltaicas elaboradas. Cor te transversal en a) y vista por la cara de la rejilla en b).



Fig. 2.4.2 Fotografía de unacelda fotovoltaica elaborada. TABLA 2.4.1 Punciones de trabajo^(1.9) $e \Phi c v_2 o = 5 e V$ = 5 e V

| and states and the second | A 1. | Ser Sugar - | | | |
|---------------------------|-----------|-------------|-----|--|--|
| e Au | | 5.1 | eV | | |
| e¢ Gu | = | 4.65 | eV | | |
| et Al | = | 4.28 | eV. | | |
| edIn | AU | 4.12 | e۷ | | |
| et Cr | e | 4.5 | eV | | |

- 111 -

transversal de la celda y en la figura (2.4.1 b) una vista de la celda por la cara de la rejilla.

Las etapas seguidas en la elaboración de las celdas fotovo<u>l</u> taicas son las siguientes:

A.- Preparación del subestrato semiconductor Cu20.

B.- Formación de la unión rectificadora Cu₂O-metal.

C.- Colocación de contactos óhmicos para la colección de los por tadores de carga fotogenerados.

D.- Soldado de hilos de cobre para conexiones externas.

Se explicará ahora cada una de las etapas anteriores. En la primera etapa (A), se preparó el subestrato semiconductor Cu_{20} oxidando láminas de cobre grado metalúrgico de l.5 x l.5 x 0.05cm en un horno con atmósfera normal, con el procedimiento descri to en la sección l.4. En la etapa (B) se hizo el contacto semi conductor-metal por evaporación al vacío del metal (Cu,In,Al y -Cr) sobre una cara del semiconductor en una evaporadora a una -presión de lo⁻⁵ torr; el grueso de una película transparente delmetal evaporado debe ser menor que 150 Å⁽¹⁷⁾. En (C), una vez ela borada la unión Cu₂O-metal, se colocaron contactos óhmicos sobre el semiconductor y sobre el metal, para la colección de los portadores de carga libres generados por la luz incidente. El con tacto óhmico en el semiconductor se hizo evaporando al vacío una

- 112 -

película gruesa de Au sobre la cara libre del semiconductor. Elcontacto óhmico en el metal también se hizo evaporando al vacíouna película gruesa de Au de forma de rejilla, que consistió deseis franjas de 0.05 cm de ancho, como se muestra en la figura -(2.4.1), para permitir la iluminación de la celda por el lado -del metal. Por último en la etapa (D), se soldaron con pintura deplata alambres de cobre a los contactos de oro para facilitar -las conexiones externas de la fotocelda.

La figura (2.4.2) muestra la fotografía de una de las cel fotovoltaicas elaboradas.

2.5 Caracterización de las celdas fotovoltaicas elaboradas.

En esta sección se obtendrán los parámetros principales delas celdas fotovoltaicas elaboradas.

Como se indicó en la sección anterior, se elaboraron celdas fotovoltaicas de barrera Schottky de Cu₂O/Cu , Cu₂O/In, Cu₂O/Aly Cu₂O/Cr , de las cuales se empezará por analizar sus caracte rísticas de rectificación; para ésto, se utiliza el circuito mog trado en la figura (2.5.1) donde se tiene una resistencia $R_s=2^{K,R}$ en serie con la celda. Dicha celda se halla en una cavidad oscura, y se le aplica un voltaje de polarización variable V_c , tan to directa -el semiconductor positivo respecto al metal-, como - inversa -el semiconductor a un potencial menor que el metal- me diante una fuente de voltaje Hewlett Packard 6111 A; el voltaje V_{10} se midió con un voltímetro Fluke. La corriente \tilde{L}_{1} se obtie ne por medio de la relación $\tilde{L}_{2} = \frac{V_{10}}{R_{0}}$ y el voltaje aplicado ala celda V_{c} por la relación $V_{c} = V_{c} - R_{0}I_{d}$. La característica $t\underline{f}$ pica corriente-voltaje de la celda, I_{1} Vs. V_{c} , para dos de las celdas elaboradas, se muestranen las gráficas de la figura--(2.5.2).

En la gráfica de la figura (2.5.3) se muestra el comporta miento experimental de la corriente de salida T₅ cuando la fotocelda se ilumina con una lámpara de filamente de tungsteno de --100 watt y además se le aplica un voltaje Ve de polarización directa e inversa, típica a los cuatro tipos de celda analizados,utilizando el mismo circuito de la figura (2.5.1), en compara -ción con su comportamiento T₄ Vs. Ve , cuando solo se aplica -polarización en la oscuridad.

Para caracterizar las celdas elaboradas como diodo rectificador, es decir, para calcular los valores de la resistencia enserie R_s, resistencia en paralelo R_{sh}, el factor de calidad A, la corriente inversa de saturación I_o y el alto de la barrera ete, ; se analiza la forma de las gráficas I_d Vs. V_c como lasque se tienen en la figura (2.5.2).

- 114 -



Pig. 2.5.1 Circuito empleado para hacer las medidas de las características de rectificación de las celdas solares.



Fig. 2.5.2 Característica corriente-voltaje. a) de la muestra - C-1 de Cu₂O/Cu.b) de la muestra C-4 de Cu₂O/In. Al aplicar en la oscuridad un voltaje V_C tanto en polarización directa como inversa.

La resistencia en serie de las fotoceldas se calcula considerando la parte recta de la gráfica I_d Vs. V_c en polarizacióndirecta cuando el factor dominante es debido a la resistencia en serie del diodo. La resistencia en serie R_s está dada por el inverso de la pendiente de dicha recta y se calcula tomando varios puntos experimentales haciendo un ajuste por mínimos cuadrados.

El cálculo de la resistencia en paralelo R_{sh} se hace a par tir de la porción recta de la relación I_d Vs. V_c en polariza-ción inversa con $V \rightarrow 0$, ya que en este caso la corriente total-pasa esencialmente a través de las resistencias en serie y paralelo del circuito equivalente -véase figura (2.3.6)-. La pendien te de dicha recta es el inverso de la suma de R_{sh} y R_s . Tomando varios puntos experimentales en esta recta y con el cálculo pre vio de la resistencia en serie se obtiene la resistencia en paralelo.

Los valores de las resistencias en serie R_s y en paralelo -R_{sh} obtenidos para cada una de las celdas analizadas están dadas en la tabla (2.5.1).

La resistencia en serie de las fotoceldas bajo iluminaciónno difiere mucho de la obtenida en la obscuridad por lo que no se tienen efectos significativos de fotoconductividad.

Como se observa de los valores de las resistencias en serie

- 116 -

y en paralelo dados en la tabla (2.5.1), sus efectos no se pue den despreciar, ya que sus valores convenientes son $R_8 < 10$ y -- $R_{sh} > 10^{\circ}$ (17). La relación entre corriente y voltaje de salida-de la fotocelda estará dada por la expresión (2.3.3), esto es,

$$I_0 = -I_{pl_1} + \frac{V_0 - I_0 R_0}{R_{oly}} + I_0 \left[e^{\frac{V_0 - I_0 R_0}{A_{WT}}} - 1 \right].$$
 (2.5.1)

Esta relación, como se mencionó antes, es difícil de manejar, -por lo que se hará una aproximación en la que el efecto de la r<u>e</u> ristencia en paralelo se considera despreciable, a reserva de -ver posteriormente si dicha aproximación es correcta. La rela -ción (2.5.1), cuando la celda no está iluminada, se reduce en e<u>s</u> ta aproximación a

$$I_{0} = I_{0} \left[e^{\frac{e(v_{0} - z_{0} R_{0})}{A v_{T}}} - 1 \right].$$
 (2.5.2)

Con la expresión (2.5.2) se puede calcular I_0 considerando el factor de calidad A = 2 en la parte recta de la relación I_d -Vs. V_c en polarización directa, en la que parece tenerse alta in yección de portadores de carga, tomando una pareja de valores ex perimentales (I,V) en dicha región. Los valores calculados para-I_o de esta manera se hallan en **la** tabla (2.5.1)

Para saber si la aproximación hecha de la relación (2.5.1)es correcta, se resuelve la relación (2.5.2) para V_a y se dan -

- 117 -

valores experimentales de la corriente para obtener los valoresvoltaje en esta aproximación. El voltaje de salida V_s es dado por

$$N_{\bullet} = I_{\bullet}R_{\bullet} + \frac{A_{\bullet}KT}{2} \ln \left(\frac{2}{2} + L\right) . \qquad (2.5.3)$$

En la expressión (2.5.3) con los valores calculados previamente para I₀ -tabla (2.5.1)- se ensayó con distintos valores de A, o<u>b</u> servándose que la mejor reproducción de los valores experimentales (dentro de 10 % de incertidumbre) es con A = 2 para la parte recta de la relación I_d Vs. V_c y valores de A en el intervalo-[1,2] para la región curva de dicha relación. Ya que los valores de V_s obtenidos con la relación (2.5.3) reproducen aceptablemen te los valores experimentales y el efecto de R_{sh} resulta despreciable, se puede considerar buena la aproximación hecha. La gráfica (2.5.4) muestra la dependencia experimental de I_s Vs. V_s en la obscuridad y los valores obtenidos con la aproximación dada por la relación (2.5.3), donde se observa un ajuste aceptable.

Para calcular el alto de la barrera e_{b} en el contacto rec tificador de las celdas se hace uso de la relación (2.2.35) considerando C = l y el factor de calidad igual a la unidad, tomando los valores obtenidos para I_o, esto es,

- 118 -



Fig. 2.5.3 Característica corriente-voltaje de la muestra C-4 de Cu_2O/In cuando se aplica una polarización en la oscuridad y bajoiluminación.



va experimental de la relación I_B Vs. V₈, para la celda C-4.

[- 119 -

Los valores del alto de la barrera et están dados en la tabla-(2.5.1).

Ahora, se determinarán las propiedades fotovoltaicas de las celdas elaboradas. Esto se hace utilizando el circuito mostradoen la figura (2.5.5), donde se tienen la fotocelda bajo iluminación en serie con una resistencia variable R_c. La iluminación de la fotocelda se provee mediante una lámpara de 100 watt. confilamento de tungsteno y la potencia incidente sobre la fotocelda se midió con un piranómetro EPLAB848 serie 752728; la resis tencia variable R está dada por una década de resistencias ----14336 General Radio; el voltaje a través de la resistencia de --carga R_m se midió con un multímetro Fluke y la corriente de sal<u>i</u> da I_s se obtiene con la relación T_s . La gráfica (2.5.6) muestra el comportamiento de la corriente de salidad I_m entregada por la fotocelda al iluminarse con una potencia incidente de-95 my el voltaje de salidad V_s a través de la resistencia de -carga R_B de tres de los cuatro tipos de celda analizados -véasefigura (2.5.5).

En la figura (2.5.7) se muestra la gráfica I Ve. V para una celda de Cu₂O/In analizada, en donde se inscribe el rectángu lo de mayor área y la forma de determinar la resistencia de carga R_L para la máxima transferencia de potencia de la fotocelda.

TABLA 2.5.1

| TIPO | CELDA | R. [.A.] | R _{sh} [2] | I° (V) | e\$.[•v] |
|----------------------|------------|----------|---------------------|-----------------------|----------|
| Cu ₂ 0/Cu | C-1 | 1160 | 2260 | 2.6 x 10 | 0.2 |
| Cu ₂ 0/In | C-4 | 900 | 5100 | 6.8 x 10 | 0.3 |
| Cu ₂ 0/In | ()-5 | 690 | 3330 | 2.3 x 10 | 0.2 |
| Cu ₂ 0/In | C-6 | 890 | 31.20 | 1.2 x 10 | 0.2 |
| Cu20/A1 | C-7 | 1390 | 64 | 2.3 x 10 | 0.2 |
| Cu ₂ 0/Cr | C-10 | 900 | 4 30 | 1.5 x 10 ⁴ | 0.2 |
| Cu ₂ 0/Cr | C-11 | 2950 | 1650 | 6.4 x 10 | 0.2 |

Valores determinados de R_s , R_{sh} , I_o y e_b de cada una de las celdas fotovoltaicas analizadas.

Lue insidente



Fig. 2.5.5 Circuito utilizado en las medidas de las carac terísticas fotovoltaicas de las celdas producidas.



TABLA 2.5.2

Resultados obtenidos de las celdas analizadas de voltaje a circuito abierto, corriente a corto circuito; voltaje, corriente y resis tencia de carga para máxima transferencia de potencia; el factor de llenado y la fotocorriente.

| TIPO DE Celda | CELDA | V _{mp} [10 ¹ v] | | RL [Ohm] | v9° [10 ⁹ v] | | P.P . | Iph (^) |
|----------------------|-------------|--|------|-------------|----------------------------|------|--------------|---------------------|
| Cu ₂ O/Cu | C-1 | 26.1 | 29 | 880 | 52 | 58 | 0.25 | 4.8x10 |
| Cu2 0/Cu | C-2 | 21.7 | 26.5 | 8 20 | 41 | 48 | 0.29 | |
| Cu ₂ 0/Cu | C-3 | 6.2 | 6.1 | 980 | 12.5 | 12.3 | 0.25 | |
| Cu ₂ 0/In | C-4 | 80 | 39.5 | 2020 | 160 | 64 | 0.31 | 1.7x10 |
| Cu ₂ 0/In | C-5 | 34.6 | 18 | 1920 | 70 | 36 | 0.25 | 8.9x10 |
| Cu ₂ 0/In | C -6 | 39 | 16.7 | 2330 | 77 | 29.5 | 0.29 | 6.7x10 |
| Cu20/A1 | C-7 | 33 | 24 | 1380 | 60 | 44 | 0.30 | 1.4x10 ³ |
| Cu ₂ 0/Cr | C-10 | 8.5 | 8 | 1060 | 17 | 16 | 0.25 | 9.7x10 |
| Cu ₂ 0/Cr | C-11 | 16 | 4.5 | 3570 | 32 | 9 | 0.25 | 7.4x10 |



Fig. 2.5.7 Voltaje y corriente de salida para una celda de Cu20/In muestra C-6, y la manera de determinar Voc, Isc, Vmp, Imp y RL al ser iluminada con una lámpara de tungsteno de 100 w .

- 123 -

P_{max} = $I_{mp}V_{mp}$. Tambien se observa en la figura (2.5.7) la determinación del voltaje a circuito abierto V_{oc} y la corriente a corto circuito I_{sc} . Los valores determinados para estos parámetros, de los cuatro tipos de celdas analizadas, se hallan condensadasen la tabla (2.5.2).

Con los parámetros determinados anteriormente, se puede evaluar el factor de llenado F.F. por medio de la expresión -----(2.3.11). Los valores de F.F. de cada una de las celdas analizadas se dan en la tabla (2.5.2).

Ahora, para calcular la fotocorriente I_{ph} se hace uso de la relación (2.5.1) bajo condiciones de circuito abierto, esto es, $V_{B} = V_{OC}$ y por tanto $I_{B} = 0$, que resolviendo para I_{ph} se obtiene

$$I_{ph} = \frac{V_{oc}}{R_{oh}} + I_{o} \left[e^{\frac{2V_{ph}}{R_{oh}}} - 1 \right]. \quad (2.5.5)$$

Los valores para I_{ph} calculados con la expresión (2.5.5)se tienen resumidos en la tabla (2.5.2).

Algunas de las celdas elaboradas sufrieron degradación y presentaron mucha inestabilidad en las medidas de corriente-voltaje por lo que no se pudieron caracterizar completamente.

La eficiencia de conversión de las fotoceldas se calculó cuando la celda es iluminada por luz artificial dada por una ---

- 124 -

lámpara de filamento de tungsteno de 100 watts cuya potencia incidente en la celda es de 95 $\frac{m\omega}{am}$ medida con un piranómetro marca EPLAB 8 serie 752728 y también cuando la fotocelda se ilumina d<u>i</u> rectamente con la luz solar, cuya potencia incidente sobre la f<u>o</u> tocelda se midió con el mismo piranómetro. La eficiencia se calculó con la expresión (2.3.10) y dada en porcentaje, es decir

$$N = \frac{ImpVmp}{P_i} \times 100 \qquad (2.5.6)$$

Para calcular la potencia de salida de la fotocelda al ser ilumi nada con luz artificial (lámpara con filamento de tungsteno), se tomaron los valores $V_{m,v}$ e $T_{m,v}$ obtenidos del tipo de gráfica ----(2.5.7) para cada una de las celdas fotovoltaicas analizadas y que se encuentran contenidos en la tabla (2.5.2); la potencia efectiva incidente sobre la fotocelda se calcula mediante el producto de la potencia incidente de 95 mW y el área efectiva A_ede la celda. Las eficiencias determinadas se dan en la tabla (2.5.3) lo mismo que las áreas efectivas de la fotocelda.

Para el cálculo de la eficiencia de las fotoceldas bajo il<u>u</u> minación solar, se utilizó el circuito de la figura (2.5.5) fi jando como resistencia de carga, la de máxima transferencia de potencia $\mathbb{R}_{\}$ determinada previamente, que se tiene en la tabla -(2.5.2). Se midió el voltaje de salida \bigvee_{mp} a través de la resistencia $\mathbb{R}_{\mathbf{k}}$ dado por la celda bajo iluminación solar y con estos valores se calculó la corriente de salida \mathbb{I}_{mp} , obteniéndose deesta manera la potencia máxima de salida entregado por la foto celda $\mathbb{P}_{max} = \mathbb{I}_{mp} \vee_{mp}$. Simultáneamente se midió la potencia so lar incidente por cm² con el piranómetro, varias veces menciona do, para determinar la potencia efectiva incidente sobre la foto celda. Las eficiencias encontradas se hallan resumidas en la tabla (2.5.4), con una incertidunbre estimada del orden de 10%.

TABLA 2.5.3

Resultados de eficiencias de las fotoceldas analizadas tanto al iluminarlas con una lámpara de filamento de tungsteno como al exponer las a la luz solar. Se muestra también las potencias incidentes y -las áreas efectivas de las fotoceldas.

| TIPO DB CELDA | CELDA | Area efectiva [cm ²] | Pi(lámp) | M (1ámp) [≉ 10 ⁻³] | P _i (sol) [] [] | ຕ (so 1) [≮ 10 [¯])] |
|----------------------|-------------|--|----------|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| Cu ₂ 0/Cu | C-1 | 1.32 | 95 | 0.6 | 88 | 2.6 |
| Cu ₂ 0/Cu | C-2 | 1.38 | 95 | 0.4 | 94 | 1.7 |
| Cu ₂ 0/Cu | C-3 | 1.21 | . 95 | 0.3 | 94 | 0.3 |
| Cu ₂ 0/In | C-4 | 1.38 | 95 | 1.4 | 95 | 3.9 |
| Cu ₂ 0/In | C-5 | 1.41 | 95 | 0.3 | 95 | 1.2 |
| Cu ₂ 0/In | C-6 | 1.39 | 95 | 0.3 | 96 | 1.3 |
| Cu ₂ 0/Al | C-7 | 1.27 | 95 | 0.7 | | |
| Cu ₂ 0/Cr | C-10 | 1.10 | 95 | 0.05 | 97 | 1.4 |
| Cu ₂ 0/Cr | C-11 | 0.76 | 95 | 0.1 | 97 | 2.7 |

2.6 Discusión y conclusiones.

El proceso de elaboración de las celdas fotovoltaicas produ cidas en este trabajo es de muy bajo costo, ya que el subestrato semiconductor Cu₂O utilizado se obtiene directamente por calenta miento a 1050 °C en atmósfera normal de láminas de cobre grado metalúrgico de 1.5 x 1.5 x 0.05 cm y el contacto rectificador por evaporación al vacío de un metal; la geometría usada es la llamada de pared anterior, donde la fotocelda se ilumina por ellado del metal. Se elboraron cuatro tipos de celdas con subestra to Cu₂O y los metales Cu, In, Al, Cr. Los cuatro tipos de celdas tuvieron características rectificadoras, aunque no todas las cel das producidas se pudieron caracterizar completamente debido a la degradación que sufrieron. Las celdas de Cu₂0/In son las quemostraron mejores características rectificadoras. El alto de labarrera del contacto rectificador metal/Cu₂O determinado es 0.2 er para las muestras analizadas, por lo que es independiente del metal utilizado en la elaboración del contacto, aunque debería espe rarse lo contrario de acuerdo con el modelo teórico de Schottky a doptado. Esta independencia del alto de barrera respecto de los metales usados en el contacto pueden tener diferentes causas: a) La existencia de gran cantidad de estados de superficie en -la interfase metal-semiconductor (3,20); b) los metales usados en

- 128 -

la elaboración del contacto rectificador reaccionan químicamentecon el Cu_2^0 generando un exceso de Cu cerca de la interfase produciéndose realmente un contacto Cu_2^0/Cu que determina el alto de la barrera ^(12,20,21,22); c) la existencia de una capa de óxidoentre el metal y el semiconductor teniéndose en lugar de un con tacto metal-semiconductor, una estructura MIS⁽¹⁾.

Los valores de V_{oc} y J_{sc} de las fotoceldas analizadas son b<u>a</u> jos respecto a los reportados en la literatura ^(12,21). Los mejores valores de Voc e Jsc obtenidos son 0.16 V y 0.046 ma/cm respectivamente para la celda C-4 de Cu₂0/In. El método de prepara-ción de la superficie del subestrato Cu₂0 previa a la formación del contacto en las referencias citadas es diferente al llevado en este trabajo, en aquellas se utilizó para la limpieza de la su perficie del subestrato ataque químico y iónico combinado que remueve mejor las impurezas superficiales del subestrato. Otro factor muy importante que produce valores bajos en J_{ac} es la alta re sistividad del subestrato semiconductor Cu₂O causada por la pequ<u>e</u> ña concentración y movilidad de portadores mayoritarios en el sub estrato, según se observó en el capítulo primero, que trae como consecuencia que muchos de los portadores fotogenerados se pier dan por recombinación en el volumen del subestrato antes de alcan zar la unión y la eficiencia de colección baje significativamen-te.

El factor de calidad de la unión A = 2 que ajusta adecuada mente los valores experimentales de corriente-voltaje sugiere que la corriente de salida está dominada por la corriente de recombinación en la región de carga espacial o que se pueda tener alta inyección de portadores minoritarios. El factor F.F. obtenido para las fotoceldas analizadas es pequeño en comparación de los reportados (12,22). Estos valores se deben principalmente a que losefectos de las resistencias en serie y en paralelo no son despreciables, como se ve en los valores determinados para la resistencia en serie de las fotoceldas que están entre 690 y 2950 ohm re sultando altos respecto a los deseables que son menores de 10 ohm (17). Las resistencias en paralelo de las celdas elaboradas son menores de 10[°] ohm que es mínimo aceptable⁽¹⁷⁾. De los datos de resistencia tanto en serie como en paralelo, se observa que sus e fectos no son despreciables y esto hace que el factor de llenado-P.P. tenga los valores citados anteriormente. De los datos registrados en la tabla (2.5.3) se observa que las celdas fotovoltai cas producidas son más eficientes al exponerlas a la luz solar que al ser iluminadas con la luz artificial de la lampara de fila mento de tungsteno, cuestión muy importante que indica posiblemen te un mejor acoplamiento de las celdas solares al espectro de emi sión solar que al de la lámpara utilizada, como se requiere en --

- 130 -

las celdas solares.

Los valores de eficiencia de las celdas producidas son ba jos respecto a los valores reportados (20,21,22) que llegan al -l \preccurlyeq , aunque como ya se explicó antes, la técnica de limpieza pre via al contacto es diferente además de que las celdas producidas en este trabajo no se recubrieron con una capa antirreflectanteque podría aumentar hasta en un 90 \preccurlyeq la respuesta espectral de la fotocelda (17). El hecho de que el factor de llenado P.P. pe queño en las celdas analizadas, trae como consecuencia que la eficiencia de las celdas fotovoltaicas producidas haya sido baja.

Con lo desarrollado en este capítulo se cumple el segundo objetivo de este trabajo al considerarse otros metales que for man contacto rectificador con el Cu₂O que no habían sido estudi<u>a</u> dos en los trabajos anteriores (5,6,7).

CONCLUSIONES GENERALES

La técnica de preparación del subestrato semiconductor Cu_2O y de las celdas fotovoltaicas elaboradas en este trabajo es de muy bajo costo, ya que el subestrato Cu₂O se obtiene de la oxid<u>a</u> ción de láminas de cobre grado metalúrgico por calentamiento **a** -1050 ^OC en atmósfera normal y el contacto rectificador por evapo ración al vacío de metales con funciones de trabajo menores queel Cu₂O . La geometría usada es la de pared anterior.

Los valores de la conductividad y concentración de portadores mayoritarios determinados en el subestrato Cu₂O son bajos p<u>a</u> ra su aplicación en celdas solares, por lo que se requiere la i<u>n</u> troducción de impurezas aceptoras para aumentar la concentración de portadores mayoritarios además de establecer condiciones másapropiadas de temperaturas y tiempos de recocido para obtener muestras de Cu₂O policristalinas con menos defectos cristalinospara aumentar la conductividad de la muestra y así que la pérdida por recombinación en el volumen de los portadores fotogenerados antes de alcanzar la unión sea mínima.

La brecha energética de Cu_2O determinada de las medidas deabsorción y transmisión es del orden de 2 ev. El espectro de ab sorción del subestrato Cu_2O se acopla adecuadamente al espectro -

- 132 -

de emisión molar y la absorción se lleva a cabo por transiciones_ directas. Estas características, además de la técnica simple para obtener el Cu₂O lo hacen muy conveniente en su aplicación para celdas solares.

La característica corriente-voltaje de las celdas produci das hacen ver que la teoría de emisión termoiónica no se ajustamuy bien a los datos experimentales, ya que la corriente inversa parece no saturarse y debe usarse probablemente la teoría de difusión o bien una teoría combinada de estas dos.

Los bajos valores encontrados para V_{ec} e J_{uc} de las celdas analizadas muestran que los efectos de las resistencias en serie y en paralelo no son desprecimbles como se observa de sus valo res calculados por lo que la eficiencia de colección espectral no es óptima.

El alto de la barrera del contacto rectificador resulta ser independiente de la función de trabajo del metal utilizado por lo que parece haber gran cantidad de estados superficiales donadores en la interfase metal-semiconductor o una reducción del --Cu₂O por el metal utilizado cerca de la interfase generándose -realmente un contacto Cu₂O/Cu que determina el alto de la barrera.

El valor para el factor de calidad de la unión considerado_

- 133 -

en las celdas fotovoltaicas producidas sugiere que el contacto me tal-semiconductor no es uniforme y que se tiene gran cantidad de impurezas en la interfase que tal vez producen una estructura — MIS en el mistema. Los valores pequeños del factor de llenado de las celdas hacer notar que los efectos de las resistencias en se rie y en paralelo son significativas y habrá de hacerse un estudio sistemático que optimice sus valores ($R_{s} \rightarrow 0$ y $R_{ah} \rightarrow \infty$).

De lo considerado en el párrafo anterior se explica que laeficiencia medida de las fotoceldas elaboradas haya sido baja -con respecto a los reportados en la literatura, aunque el proceso de limpieza de la superficie del subestrato previa al contacto es diferente del hecho en este trabajo; hay que tomar en cue<u>n</u> ta también que a las celdas elaboradas aquí no se aplicó recubr<u>i</u> miento antirreflectante, que en las celdas de pared anterior, es un factor muy importante debido a la alta reflectividad de los metales y la eficiencia real de las fotoceldas debe ser mayor -que la medida.

Para optimizar los parámetros (A y F.F.) que determinan laeficiencia de conversión de las fotoceldas metal/Cu₂O que se el<u>a</u> boren en trabajos posteriores es necesario tener especial cuidado en:

a) Seleccionar un metal que no reaccione químicamente con - -

- 134 -

el subestrato Cu₂O para que realmente el alto de barrera dependa del metal utilizado.

b) Aumentar la conductividad del subestrato semiconductor -Cu₂O por inclusión de impurezas apropiadas que incremente el número de portadores mayoritarios y optimizar las temperaturas y tiempos en el proceso de su elaboración para lograr muestras policristalinas con menos defectos estructurales o aún monocristales y evitar al máximo la pérdida por recombinación en el volu men de los portadores fotogenerados antes de que alcancen la u nión.

c) La limpieza de la superficie del subestrato previo al -contacto que es un factor determinante para obtener contactos uniformes y libres de impurezas.

d) Los contactos óhmicos para la colección de portadores fo togenerados, tanto en la geometría más apropiada como evitar laoxidación antes y después de su colocación.

e) El recubrimiento antirreflectante que además evite la oxidación de la fotocelde.

Con el presente trabajo se logra un avance en el proyecto --de celdas solares a base de Cu₂O del Instituto de Investigacio --nes en Materiales de la U.N.**C.N.** al haberse estudiado el sistema-metal/Cu₂O con diferentes metales y caracterizarse el subéstrato-

- 135 -

semiconductor Cu₂O utilizado.

Por último, considerando las grandes ventajas señaladas quetiene el subestrato semiconductor Cu_2^0 , sería conveniente hacer investigaciones de otros sistemas fotovoltaicos a base de Cu_2^0 que minimicen los problemas encontrados en los contactos metal / Cu_2^0 y que más aún, tengan otras ventajas. Tales sistemas podrían ser MIS con un aislante que no reduzca el Cu_2^0 y heterouniones con base de Cu_2^0 , que por los estudios preliminares que se tienen al presente parecen tener muy buenas perspectivas.

136 -

BIBLIOGRAFIA

- L. C. Olsen and R. C. Bohara, "Experimental and Theoretical studies of Cu₂O Schottky barrier solar cells". IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 381-390 (1975).
- 2. Dr. Morton Prince. Comunicación personal.
- 3. E. H. Rhoderiek, "The Physics of Schottky barriers". J. Phys. D: Appl. Phys. Vol. 3, 1153-1167 (1970).
- 4. V. P. Smirnov, "Band structure of cuprous oxide crystal". So viet Physics-Solid State Vol. 8, No. 8, 2020 February (1967).
- A. Sánchez J., "Celdas Solares de Cu-Cu₂O de barrera Schott ky, de pared anterior". Tesis profesional (licenciatura) UNAM (1979).
- 6. S. López R., "Celdas Solares de Barrera Schottky". Tesis profesional (licenciatura) UNAM. (1979).
- 7. F. Zapién N., "Celdas fotovoltaicas de Barrera Schottky". Tesis profesional (licenciatura) UNAM. (1978).
- 8. K. V. Shalimova, "Fisica de los Semiconductores". Ed. Mir (1975).
- 9. C. Kittel, "Introduction to Solid State Physics". Ed. John Wiley and Sons, Inc., 4ª edición (1971).
- 10. R. H. Bube, "Electronic Properties of Crystalline Solids". Ed Academic Press (1974) pp 401-420.
- 11. D. Rios J. "Estudio del daño por radiación alfa en Cu₂O a tem peratura ambiente". Tesis profesional (licenciatura) UNAM. --(1974).
- 12. D. Trivich, E. Y. Wang, R. J. Komp and A. S. Kakar, "Cuprousoxide photovoltaic cells". IEEE Photovoltaic Specialists conference, 174-179 (1978).
- 13. J. A. Assimos and D. Trivich, "Photovoltaic properties and ba-

- 137 -.

rrier heights of single-crystal and policrystal Cu₂o-Cu Con - tacts". J. A. P. Vol. 44, No. 4, 1637-1693 April (1973).

- 14. W. H. Brattain, "The Coper oxide Rectifier". Reviews and Mo --dern Physics, Vol. 23, No. 3, 203-212 July (1951).
- 15. J. P. Mc Kelvey, "Solid State and Semiconductor Physics". Har per and Row P. International (1966).
- 16. A. G. Milnes and D. L. Fencht. "Heterojunctions and Metal-Semiconductor Junctions". Ed. Academic Press 1^a Edición (1972)-Capt. I.
- 17. H. Hovell, "Solar Cells". Academic Press, New York (1975).
- 18. J. J. Loferski, "Principles of Photovoltaic Solar Energy Conversion". IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 1-4 ----(1973).
- 19. H. B. Michaelson, "The work function of the elements and itsperiodicity". J.A.P. Vol. 48, No. 11, 4729-4733, November --(1977).
- 20. L. C. Olsen and R. C. Bohara, "Explanation for low-efficiency Cu₂O Schottky Barrier Solar Cells". Appl. Phys. Lett. 34 (1)-1 January (1979), pp 47-49.
- 21. J. Herion, "Chemical irigin of Space-charge layer in Cuprousoxide front-wall Solar Cells". Appl. Phys. Lett. <u>34</u> (9), 1 -May (1974). pp 599-601.
- 22. J. Herion, B. Natsch, E. A. Niekisch and G. S. Charl, "Preparation and Analysis of Cu₂O thin-film Solar Cells". Photovoltaic Solar Energy Conference, Berlin (1974).

- 138 -